

北京海润天睿律师事务所
关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书

[2019]海字第 017 号

中国·北京

目 录

释义

声明

正文

一、股份公司本次发行上市的批准和授权

二、股份公司本次发行上市的主体资格

三、股份公司本次发行上市的实质条件

四、股份公司的设立

五、股份公司的独立性

六、股份公司的发起人或股东

七、股份公司的股本及其演变

八、股份公司的业务

九、关联交易及同业竞争

十、股份公司拥有的主要资产

十一、股份公司的重大债权债务

十二、股份公司的重大资产变化及收购兼并

十三、股份公司章程的制定与修改

十四、股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

十五、股份公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

十六、股份公司的税务

十七、股份公司的环境保护和产品质量、技术标准

十八、股份公司募集资金的运用

十九、股份公司业务发展目标

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

二十一、股份公司招股说明书的法律风险评价

二十二、结论意见

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

发行人、股份公司、和舰芯片	指	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司
和舰有限公司	指	发行人前身和舰科技（苏州）有限公司
本次发行上市	指	股份公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市
本所、本所律师	指	北京海润天睿律师事务所、北京海润天睿律师事务所承办股份公司本次发行上市法律事务的经办律师
《法律服务协议》	指	发行人与本所签订的《和舰科技（苏州）有限公司首次公开发行 A 股股票及上市的法律服务协议》
本法律意见书	指	本所为股份公司本次发行上市出具的法律意见书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（根据 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正）
《科创板实施意见》	指	《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》
《科创板首发管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《证券期货法律适用意见第 1 号》	指	中国证监会颁布的《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》
《若干意见》	指	《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》
《通知》	指	《对外贸易经济合作部办公厅关于外商投资股份公司有关问题的通知》
《编报规则 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——〈公开发行证券的法律意见书和律师工作报告〉》
《律师证券业务管理办法》	指	中国证券监督管理委员会令第 41 号《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师执业规则》	指	中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部公告[2010]33 号——《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
橡木联合	指	股份公司发起人、直接控股股东 Oakwood Associates Limited
投资联盟	指	股份公司间接控股股东 Invest League Holding Limited，2002 年 4 月更名为 Best Elite International Limited。
晶信科技	指	股份公司间接控股股东 Infoshine Technology Limited

菁英国际	指	股份公司间接控股股东 Best Elite International Limited, 2002 年 4 月由投资联盟更名而来
联华电子、联电、UMC	指	股份公司最终控股股东中国台湾上市公司联华电子股份有限公司
富拉凯咨询	指	股份公司发起人富拉凯咨询（上海）有限公司
香港 Friendly	指	富拉凯咨询股东 Friendly Holdings (HK) Co., Limited
厦门联芯	指	发行人的子公司联芯集成电路制造（厦门）有限公司，原名厦门联芯集成电路制造有限公司
山东联暲	指	发行人全资子公司联暲半导体（山东）有限公司
厦门联和	指	厦门联芯投资拥有权益的合伙企业厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
厦门金圆	指	厦门联芯股东厦门金圆产业发展有限公司
福建电子集团	指	厦门联芯原股东福建省电子信息（集团）有限责任公司
福建电子创业投资	指	厦门联芯股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）
联华微芯	指	厦门联芯股东 United Microchip Corporation
绿色星球	指	厦门联芯间接股东 Green Earth Limited
美国联电	指	联华电子全资子公司 UMC GROUP (USA)
日本联电	指	联华电子全资子公司 UMC GROUP (JAPAN)
宏诚投资	指	联华电子全资子公司宏诚创业投资股份有限公司
弘鼎投资	指	联华电子全资子公司弘鼎创业投资股份有限公司，
联旭能源	指	联华电子全资孙公司联旭能源开发股份有限公司
永盛香港	指	联华电子全资孙公司永盛能源投资（香港）有限公司
永盛山东	指	联华电子曾孙公司永盛（山东）能源有限公司
OMNI	指	联华电子全资子公司 Omni Global Limited
联颖光电	指	联华电子控股子公司联颖光电股份有限公司
联颖光电投资	指	联华电子全资孙公司联颖光电投资（萨摩亚）有限公司
联相光电	指	联华电子控股子公司联相光电股份有限公司
联京光电	指	联华电子曾经的控股子公司联京光电股份有限公司
联咏科技	指	股份公司的关联方联咏科技股份有限公司
盛群半导体	指	股份公司的关联方盛群半导体股份有限公司
智原科技	指	股份公司的关联方智原科技股份有限公司
联阳半导体	指	股份公司的关联方联阳半导体股份有限公司
原相科技	指	股份公司的关联方原相科技股份有限公司
三重富士通	指	股份公司的关联方 Mie Fujitsu Semiconductor Limited
美日光罩	指	股份公司的关联方台湾美日先进光罩股份有限公司

福建晋华	指	股份公司的关联方福建省晋华集成电路有限公司
欣兴电子	指	股份公司的关联方欣兴电子股份有限公司
矽统科技	指	股份公司的关联方矽统科技股份有限公司
迅捷投资	指	股份公司的关联方迅捷投资股份有限公司
盟智科技	指	股份公司的关联方盟智科技股份有限公司
《股份公司章程》	指	发行人设立时于 2018 年 6 月 21 日召开的创立大会暨第一次股东大会通过的现行有效的《和舰芯片制造（苏州）股份有限公司章程》
《股份公司章程（草案）》	指	发行人于 2019 年 3 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会通过的将在上市后生效的《和舰芯片制造（苏州）股份有限公司章程（草案）》
大华会计师事务所	指	发行人本次发行的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》	指	（台湾）普华商务法律事务所出具的发文字号为 19001019 的《关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司、联芯集成电路制造（厦门）有限公司之台湾地区及部分海外地区关系企业法律意见书》
（台湾）普华商务法律事务所出具的《专项法律意见书》	指实际	（台湾）普华商务法律事务所就联华电子与 Micron Technology, Inc. 于中国台湾地区及美国所涉之诉讼出具的普字第 19001009 号《法律意见书》
元	指	人民币元
ADR	指	American Depositary Receipt 简称，中文美国存托凭证，是美国商业银行为协助外国证券在美国交易而发行的一种可转让证书。通常代表非美国公司可公开交易的股票和债券
微米、 μm	指	10^{-6} 米 (m)
纳米、nm	指	10^{-9} 米 (m)
IC、芯片、集成电路	指	Integrated Circuit 简称，将一定数量的电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
集成电路设计、IC 设计	指	Integrated Circuit Design，是电子工程学和计算机工程学的的一个学科，其主要内容是运用专业的逻辑和电路设计技术设计集成电路
IP	指	知识产权 (Intellectual Property) 的缩写，是一种无形的财产权，也称智力成果。在集成电路行业一般指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。
报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度
保荐机构	指	发行人本次发行上市的保荐人长江证券承销保荐有限公司

北京海润天睿律师事务所
关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书

[2019]海字第 017 号

致：和舰芯片制造（苏州）股份有限公司

根据股份公司与本所签订的《法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。本所律师根据《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》、《若干意见》、《通知》、《律师证券业务管理办法》、《编报规则 12 号》、《律师执业规则》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的其他有关规定，以及本所与发行人签订的《法律服务协议》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见并出具本法律意见书。

声 明

对本所出具的本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本所及项目组律师依据《证券法》、《编报规则 12 号》、《律师证券业务管理办法》和《律师证券执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师在工作过程中，已得到发行人的保证：即发行人业已向本所律师提供了本所律师认为制作本法律意见书和律师工作报告所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的复印件、副本与原件、正本一致，其所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

3、本所律师仅就与发行人本次发行上市有关法律问题发表意见，本所律师

在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对会计、审计及资产评估等其他业务事项已履行发行人律师相应的注意义务，本法律意见书及律师工作报告涉及相关内容的，均为严格按照有关中介机构出具的报告或发行人的文件引述。

4、对于本法律意见书及律师工作报告至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明以及发行人对有关事实和法律问题的声明和承诺出具本法律意见书。

5、本所律师同意发行人在《招股说明书》中按中国证监会审核要求引用本法律意见书和律师工作报告的有关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，否则本所律师对《招股说明书》引用的有关内容，将进行再次审阅及确认。

6、本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人申请公开发行股票所必备的法律文件，随其他材料一同上报；本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作其他任何目的。

正 文

一、股份公司本次发行上市的批准和授权

为查验发行人本次发行上市事项的批准和授权，本所律师核查了发行人提供的有关本次发行上市的董事会、股东大会会议通知、会议议案、签到簿、表决票、会议决议及会议记录等正本复印件，为本次发行上市编制的《和舰芯片制造（苏州）股份有限公司集成电路芯片技术改造产能扩充项目可行性研究报告》，并与发行人保存的相关文件原件进行比对；在此基础上，本所律师对发行人本次发行上市的批准和授权是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）股份公司已依法定程序作出本次发行上市的决议

1、2019年3月2日，股份公司召开第一届董事会第七次会议，本次董事会依法就本次发行上市的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请股份公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、2019年3月17日，股份公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合科创板定位及首次公开发行A股股票并在科创板上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行A股股票并在科创板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行A股股票并在科创板上市募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施的承诺的议案》、《关于公司稳定股价措施的议案》、《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》、《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》、《关于上市后持股5%以上股东减持公司股票事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行A股股票及上市事宜的议案》等议案。上述议案的主要内容如下：

(1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。

(2) 本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过 40,000 万股，且不低于股份公司发行后总股本 10%，股份公司股东不公开发售股份，具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终经中国证监会注册的数量为准。

(3) 本次发行对象：网下发行对象：符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等规定条件的投资者；网上发行对象：符合《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定条件的二级市场投资者。

(4) 本次发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

(5) 本次发行价格或定价方式：通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式。

(6) 募集资金用途：本次发行的具体募集资金数额，将由最终确定的发行价格和经中国证监会注册的发行股数决定。股份公司通过公开发行新股募集的资金用于以下项目：

序号	项目名称	募投项目投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	和舰芯片制造（苏州）股份有限公司集成电路芯片技术改造产能扩充项目	249,935.80	200,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		299,935.80	250,000.00

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式自筹解决。本次募集资金投资项目已经股份公司第一届董事会第二次会议审议通过，本次发行募集资金到位之前，股份公司根据项目进度的实际情况

以自筹资金已先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

(7) 本次发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存利润（累计未弥补亏损）由股份公司公开发行股票并在科创板上市后登记在册的新老股东共享（共担）。

(8) 本次发行股票的拟上市地：上海证券交易所。

(9) 决议有效期：24 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算，该决议有效期内本次发行上市若通过上海证券交易所审核和取得中国证监会注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

(10) 稳定股价措施及其启动条件

① 稳定股价措施的启动条件

发行人股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于发行人上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末发行人股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），发行人及其控股股东、董事、高级管理人员将启动相应的措施，稳定发行人股价。

② 发行人稳定股价承诺及约束措施

A、当发行人需要采取股价稳定措施时，发行人将在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定、获得监管机构或其他相关机关的批准（如需）、且不应导致发行人股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购发行人部分股票。发行人将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，

发行人依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

B、发行人回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前发行人股价已经不能满足启动稳定发行人股价措施的前提条件的，可不再继续实施该方案。

C、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括发行人实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），发行人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：a、单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，和 b、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，发行人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

D、若发行人新聘董事（不包括独立董事）、高级管理人员的，发行人将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已经作出的相关承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人未采取上述稳定股价的具体措施，发行人承诺接受以下约束措施：发行人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，应依法进行赔偿；发行人应按照中国证监会或上海证券交易所的要求进行及时整改。

③ 发行人控股股东稳定股价承诺及约束措施

控股股东橡木联合、晶信科技、菁英国际、联合电子（以下统称承诺人）承诺：在股价稳定措施启动条件成就后，将依据法律、法规及发行人章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：

A、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，承诺人将以增持发行人股份的方式稳定股价。承诺人应在三个交易日内，提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知发行人，发行人应按照规定披露承诺人增持发行人股份的计划。在发行人披露承诺人增持发行人股份计划的三个交易日后，承诺人开始实施增持发行人股份的计划。

B、承诺人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不满足启动稳定发行人股价措施的条件，承诺人可不再实施增持发行人股份。

C、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），承诺人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：a、单次用于增持股份的资金金额不低于承诺人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%，和 b、单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后承诺人累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，承诺人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

D、如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，承诺人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。

E、承诺人增持发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。承诺人增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如承诺人未采取上述稳定股价的具体措施，承诺人承诺接受以下约束措施：a、承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；b、如果承诺人未采取上述稳定股价的具体措施的，则承诺人停止从发行人处获得股东分红，且承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

④发行人全体董事（独立董事除外）和高级管理人员稳定股价承诺及约束措施

发行人全体董事（独立董事除外）、高级管理人员（以下统称承诺人）承诺：将依据法律、法规及发行人章程的规定，不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：

A、当发行人需要采取股价稳定措施时，在发行人、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，发行人股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，承诺人应通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股票以稳定发行人股价。发行人应按照规定披露承诺人买入发行人股份的计划。在发行人披露承诺人买入发行人股份计划的3个交易日后，承诺人将按照方案开始实施买入发行人股份的

计划。

B、通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。

C、若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括承诺人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），承诺人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：a、单次用于购买股份的资金金额不低于承诺人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 20%，和 b、单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过承诺人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

D、承诺人买入发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。承诺人买入发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如承诺人未采取上述稳定股价的具体措施，承诺人承诺接受以下约束措施：a、承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；b、如果承诺人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人领取薪酬或津贴及股东分红，同时承诺人持有的发行人股份不得转让，直至承诺按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

(11) 关于股份回购及赔偿投资者

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会认定有关违法事实后 3 个交易日内启动依法回购首次公开发行的全部新股的工作。回购价格按照发行人股票发行价格加同期银行存款利率确定；如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。但发行人能够证明自己没有过错的除外。

若发行人违反上述承诺，发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失。

(12) 关于股份公司本次发行上市摊薄即期回报填补措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，并经发行人 2019 年第二次临时股东大会审议批准，发行人拟通过加快市场开拓、以自有资金先行投入，争取早日实现募投项目预期效益、严格执行既定股利分红政策，保证股东回报的及时性和连续性等方式，积极提升发行人盈利能力，填补被摊薄的股东即期回报。具体如下：

第一、加快市场开拓，努力提高发行人的收入水平

发行人主要从事 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造业务，涵盖 28nm、40nm、90nm、0.11 μm 、0.13 μm 、0.18 μm 、0.25 μm 、0.35 μm 、0.5 μm 等制程。发行人不断巩固并加强发行人的市场地位，收到了良好的市场效果。未来，发行人将进一步拓展现有产品和服务的市场规模，进一步丰富本发行人现有制程的特色工艺、加快先进制程的研发和引进，提升发行人的盈利能力。

第二、以自有资金先行投入，争取早日实现募投项目预期效益

发行人首次公开发行募集资金投资项目为和舰芯片制造（苏州）股份有限公司集成电路技术改造产能扩充项目和补充流动资金。发行人现有主营业务为 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造业务，集成电路技术改造产能扩充项目实施是对发行人现有生产能力的提升。通过项目实施，核心产品的产能将较大幅度提高，核心竞争优势进一步突显，发行人将实现在经营规模稳定增长的同时，盈利能力得到快速提高。通过补充流动资金，将有效增加发行人营运资金，从而增强发行人的新产品研发能力和新市场开拓能力，进而提升发行人的收入和利润水平。

为有效填补首次发行对股东即期回报的摊薄，发行人可以使用自有资金先行投入，争取早日实现募投项目预期效益。

第三、严格执行既定股利分红政策，保证股东回报的及时性和连续性

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规，为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，发行人制定了《股份有限公司章程（草案）》，完善了利润分配制度。为保证股东回报机制的连续性和稳定性，发行人制定《和舰芯片制造（苏州）股份有限公司上市后未来三年分红规划》，进一步落实分红政策。

第四、进一步优化治理结构、加强内部控制，提升经营决策效率和盈利水平

自成立以来，多年的经营积累和技术储备为发行人未来的发展奠定了良好的基础。发行人将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省发行人的各项费用支出，全面有效地控制发行人经营和管控风险，提升经营决策效率和盈利水平。

（13）股份公司董事、高级管理人员执行发行人填补回报措施的承诺

股份公司董事（不含独立董事）、高级管理人员就执行发行人填补回报措施承诺如下：

①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；

②对本人的职务消费行为进行约束；

③不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

④同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

⑤如股份公司未来实施股权激励，本人承诺发行人未来股权激励的行权条件将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的赔偿责任及监管机构的相应处罚。

（14）未来新聘董事、高级管理人员遵守稳定股价的承诺：股份公司上市后，对于未来新聘任的董事、高级管理人员，必须履行上市时董事、高级管理人员做出的稳定股份公司股价的承诺。

（15）股份公司持股 5%以上股东关于锁定期满后持股意向的承诺及约束措施

发行人控股股东橡木联合、晶信科技、菁英国际、联华电子（以下统称承诺人）承诺：

①承诺人作为持有发行人 5%以上股份的股东，将严格履行发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的股票锁定承诺。

②在承诺人所持发行人股份锁定期届满后，承诺人暂无减持发行人股份的意向。如需减持发行人股份，将按照符合相关法律法规及上海证券交易所的相关规则要求进行减持。

发行人控股股东橡木联合、晶信科技、菁英国际、联华电子将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：A、如果未履行上述承诺事项，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；B、如果未履行上述承诺事项，承诺人持有发行人的股票的锁定期限自动延长 6 个月；C、如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

(16) 股份公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜如下：

股份公司股东大会授权董事会在股东大会决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理股份公司本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括但不限于：

①根据中国证监会、上海证券交易所的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等发行上市具体方案事项；

②募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由股份公司通过自筹资金解决，或由董事会按股份公司经营发展需要的迫切性，在投资项目中决定优先实施的项目；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

③签署本次发行股票并上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；

④根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织等提交各项与本次发行上市有关的所有必要文件；根据需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户等办理与本次发行上市的相关手续；

⑤对于股东大会、董事会审议通过的股份公司因本次发行上市的需要而根据法律、法规及其他规范性文件制定、股份公司上市后股东分红回报三年规划、股份公司上市后三年稳定股价预案、股份公司上市摊薄即期回报及填补措施等申

请文件内容，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况进行调整和修改；

⑥根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理股份公司注册资本变更等相关工商登记事宜；

⑦在发行决议有效期内，若首次公开发行股票政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；在不违反相关法律法规的情况下，办理其认为与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜，包括但不限于根据中国法律法规及证券监督管理部门的有关规定以及本次发行上市的实际需要，作出相关的承诺；

⑧全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

本次授权的有效期：24 个月，自股份公司股东大会通过之日起计算。该授权有效期内本次发行上市若通过上海证券交易所审核和取得中国证监会注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决方式以及会议形成的决议符合《公司法》、《股份公司章程》及其他有关规定，股份公司股东大会已依法定程序作出了本次发行上市的决议。

（二）经本所律师核查，发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体已分别就稳定股价、股票回购、赔偿投资者、股票减持等事项做出承诺。上述相关责任主体关于履行其所作出承诺已制定相应的约束措施。本所律师认为，发行人及其控股股东、董事、监事和高级管理人员作出的相关承诺已经履行了相应的决策程序，相关承诺及约束措施合法、有效。

（三）本次股东大会授权董事会在决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理本次发行上市的有关事宜，上述授权范围及程序合法、有效。

（四）根据（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》及联华电子

公开披露的信息，就发行人本次发行上市事宜，联华电子于 2018 年 6 月 29 日召开董事会，审议通过发行人本次发行上市的相关事项并提请股东会审议，2018 年 8 月 20 日，联华电子召开 2018 年第一次股东临时会议，审议通过发行人本次发行上市的相关事项。就发行人本次发行上市相关事项，联华电子已依据中国台湾法律履行了相关决策程序及信息披露程序，合法、有效。

（五）本所律师认为，股份公司本次发行上市现阶段已取得了必要的批准和授权，股份公司本次发行上市尚需获得上海证券交易所审核及中国证监会同意注册。

二、股份公司本次发行上市的主体资格

本所律师核查了发行人提供的股份公司内部决策文件和全套工商登记档案以及相关合同、协议等资料，并对上述资料的内容、性质和效力等进行了必要的查验、分析和判断，并取得了发行人出具的相关声明与承诺；在此基础上，本所律师对发行人本次发行上市的主体资格是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规和规范性文件的规定予以验证。

（一）股份公司为在原有限责任公司——和舰有限公司的基础上整体变更以发起设立方式设立的股份有限公司。和舰有限公司成立于 2001 年 11 月 23 日，2018 年 6 月 22 日，和舰有限公司整体变更发起设立为“和舰芯片制造（苏州）股份有限公司”。

2018 年 6 月 20 日，和舰有限公司原股东橡木联合、富拉凯咨询两名股东签订《发起人协议书》，就共同出资以发起方式设立股份公司的有关事宜达成一致。2018 年 6 月 22 日，股份公司在江苏省工商行政管理局办理注册登记，并取得换发的统一社会信用代码为 91320594732513557J 的《营业执照》，公司名称为“和舰芯片制造（苏州）股份有限公司”，注册资本为 320,501.4276 万元。

发行人现持有江苏省工商行政管理局于 2018 年 6 月 22 日颁发的统一社会信用代码为 91320594732513557J 的《营业执照》，类型为股份有限公司（中外合资，未上市），住所为苏州工业园区星华街 333 号，法定代表人为洪嘉聪，注册资本

320, 501. 4276 万元, 经营范围为“研究、开发、设计、制造以下产品:集成电路;各种半导体零组件, 包括混合电路(HYBRID CIRCUIT)、集成电路(IC)卡及电路模块;微处理器、外围支持之零组件及系统产品, 包括密着型影像传感器(CIS)、液晶显示器(LCD); 半导体记忆体记忆零组件及其系统产品; 太阳能电池及其相关之系统模组与产品; 集成电路测试与包装; 光罩制作。在国内外销售本公司的产品并提供相关服务; 从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务; 以及相关半导体工程设计咨询、工程管理咨询、经营管理咨询及相关配套服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

(二) 根据法律、法规、规范性文件和《股份公司章程》以及股份公司提供的工商资料, 股份公司为依法设立并合法存续的股份有限公司, 不存在法律、法规、规范性文件及《股份公司章程》中规定的需要终止的情形。

本所律师认为, 发行人系依照法律程序由和舰有限公司整体变更以发起设立方式设立且合法有效存续的股份有限公司, 股份公司具备《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》及其他法律、法规、规范性文件等规定的本次发行上市的主体资格。

三、股份公司本次发行上市的实质条件

为查验股份公司是否具备本次发行上市的实质条件, 本所律师核查了股份公司全套工商登记档案, 核查了股份公司股东大会、董事会、监事会会议文件及相关各项法人治理制度等正本复印件, 并与股份公司保存的相关文件原件进行比对; 核查了大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、大华核字[2019]000905号《内部控制鉴证报告》、大华核字[2019]000906号《主要税种纳税情况说明的鉴证报告》、大华核字[2019]000907号《非经常性损益鉴证报告》; 取得了发行人与直接或间接控股股东签署的《避免同业竞争协议》、控股股东联华电子近三年来披露的公开信息; 取得了(台湾)普华商务法律事务所出具的《法律意见书》、《专项法律意见书》; 对股份公司股东、董事、监事、高级管理人员进行问卷调查并取得尽职调查问卷; 查验了股份公司及其董事、监事、高级管理人员出具的书面声明与承诺; 本所律师取得了有关政府主管部门出具的守法证明。

在此基础上，本所律师对股份公司本次发行上市的实质条件是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规和规范性文件的规定予以验证。

(一) 股份公司本次发行属于股份公司首次公开增资发行。

(二) 股份公司本次发行上市符合《公司法》、《证券法》规定的实质条件：

1、股份公司本次发行的股票为同种类股票人民币普通股，每股面值为人民币 1 元，属于境内上市内资股；股份公司本次发行实行公平、公正原则；每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利；符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、股份公司本次发行的股票价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

3、股份公司本次发行的股票形式属于中国证监会规定的其他形式，符合《公司法》第一百二十八条的规定。

4、股份公司本次发行的股票属于记名股票，符合《公司法》第一百二十九条的规定。

5、股份公司已召开股东大会对本次发行股票的种类及数额、发行价格等事项形成合法、有效的决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

6、根据股份公司提供的资料、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939 号《审计报告》、大华核字[2019]000905 号《内部控制鉴证报告》并经本所律师核查，股份公司本次发行符合下列条件：①具备健全且运行良好的组织机构；②最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；③经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项、第（三）项、第（四）项的规定。

根据股份公司提供的资料、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、大华核字[2019]000905号《内部控制鉴证报告》、发行人正在履行的重大经营合同及本所律师核查，2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日发行人归属于母公司股东的净资产分别为388,876.68万元、409,175.49万元与446,486.48万元；发行人盈利能力具有可持续性，2016年度、2017年度、2018年度，发行人营业收入分别为187,764.48万元、335,988.64万元与369,403.22万元；发行人具有较好的偿债能力，截止2018年12月31日，发行人资产负债率58.78%，流动比率1.73，速动比率1.64。发行人财务状况良好，具有持续盈利能力，符合《证券法》第十三条第一款第(二)项的规定。

(三) 股份公司本次发行上市符合《科创板首发管理办法》规定的发行条件

1、根据股份公司提供的资料、签署的尽职调查问卷或出具的声明与承诺并经本所律师核查，和舰有限公司成立于2001年11月23日，股份公司在原有限责任公司一和舰有限公司的基础上按原账面净资产值折股整体变更以发起方式设立的股份有限公司，股份公司依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；股份公司目前下设董事会办公室、生产制造处、市场销售处、资材处、厂务暨扩建处、品质暨可靠度保证处、人力资源处、会计暨财务处、风险管理暨安环处、资讯工程处、内部审计处、研究发展处等生产经营和管理部门，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，股份公司已具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《科创板首发管理办法》第十条的规定。

2、根据股份公司提供的资料、签署的尽职调查问卷或出具的声明与承诺及大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、大华核字[2019]000905号《内部控制鉴证报告》，股份公司会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《科创板首发管理办法》第十一条第一款的规定。

3、根据股份公司提供的资料、签署的尽职调查问卷或出具的声明与承诺及

大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、大华核字[2019]000905号《内部控制鉴证报告》，股份公司内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证股份公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留意见的《内部控制鉴证报告》，符合《科创板首发管理办法》第十一条第二款的规定。

4、根据股份公司提供的资料、控股股东签署的声明与承诺并经本所律师核查，股份公司业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《科创板首发管理办法》第十二条的规定。

(1) 根据股份公司提供的资料、发行人与直接或间接控股股东签署的《避免同业竞争协议》、控股股东联华电子近三年来披露的公开信息、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、发行人签署的尽职调查问卷或出具的声明与承诺，股份公司资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《科创板首发管理办法》第十二条第（一）项的规定。

(2) 根据股份公司提供的资料、控股股东联华电子签署的声明与承诺、控股股东联华电子近三年来披露的公开信息、（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》、《专项法律意见书》并经本所律师核查，股份公司最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，股份公司无实际控制人，不存在最近两年实际控制人发生变更、导致控制权可能变更的重大权属纠纷的情形，符合《科创板首发管理办法》第十二条第（二）项的规定。

(3) 根据股份公司提供的资料、签署的尽职调查问卷或出具的声明与承诺及大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、本所律师登入全国法院被执行人信息查询网站、发行人所在地法院网站、仲裁委员会网站的检索，股份公司发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《科创板首发管理办法》第

十二条第（三）项的规定。

5、根据股份公司提供的资料及大华出具的[2019]001939号《审计报告》并经本所律师核查，股份公司目前的经营范围为“研究、开发、设计、制造以下产品：集成电路；各种半导体零组件，包括混合电路（HYBRID CIRCUIT）、集成电路（IC）卡及电路模块；微处理器、外围支持之零组件及系统产品，包括密着型影像传感器（CIS）、液晶显示器（LCD）；半导体记忆体记忆零组件及其系统产品；太阳能电池及其相关之系统模组与产品；集成电路测试与包装；光罩制作。在国内外销售本公司的产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；以及相关半导体工程设计咨询、工程管理咨询、经营管理咨询及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

股份公司主要从事 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造业务，涵盖 28nm、40nm、90nm、0.11 μm 、0.13 μm 、0.18 μm 、0.25 μm 、0.35 μm 、0.5 μm 等制程。2014 年 9 月 2 日，经江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局批准，发行人被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201432001302，有效期三年。2017 年 11 月 17 日，经江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局批准，发行人被重新认定为高新技术企业，证书编号为 GR201732001868，有效期三年。

根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GBT 4754-2011），股份公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），股份公司所属行业“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

根据股份公司出具的《关于符合科创板定位要求的专项说明》、发行人提供的资料及本所律师核查，股份公司主营业务为 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造业务，股份公司属于上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》规定的“新一代信息技术领域”中的“半导体和集成电路”科技创新企业，股份公司生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。发行人符合科创板定位要求，符合《科创板首发管理办法》第十三条第一款的规定。

6、根据股份公司提供的资料、签署的尽职调查问卷或出具的声明与承诺、控股股东签署的访谈记录、控股股东签署的尽职调查问卷、承诺函、（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》、《专项法律意见书》并经本所律师核查，最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《科创板首发管理办法》第十三条第二款的规定。

7、根据股份公司提供的资料、股份公司董事、监事、高级管理人员签署的尽职调查问卷、出具的相关承诺、（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》并经本所律师核查，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《科创板首发管理办法》第十三条第三款的规定。

（四）股份公司本次发行上市符合《科创板上市规则》及规定的上市条件

1、根据股份公司提供的资料并经本所律师核查，股份公司符合中国证监会颁布的《科创板首发管理办法》规定的发行条件，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

2、根据股份公司提供的最新的营业执照、验资报告、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939 号《审计报告》并经本所律师核查，股份公司股本总额为 320,501.4276 万股，本次发行不超过 40,000 万股，本次发行后股本总额不低于 3,000 万元，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

3、根据股份公司提供的最新的营业执照、验资报告、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939 号《审计报告》并经本所律师核查，股份公司股本总额为 320,501.4276 万股，股份公司股本总额超过 4 亿元，本次发行不超过 40,000 万股，不低于股份公司发行后总股本 10%，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

4、根据股份公司提供的资料及大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》并经本所律师核查，股份公司股本总额为320,501.4276万股，截至2018年12月31日，股份公司归属于母公司的股东权益合计4,464,864,839.96元，最近一年营业收入为369,403.22万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为738,582.63万元，符合《科创板上市规则》第2.1.1条第（四）项、第2.1.2条第（四）项的规定。

（五）股份公司本次发行上市符合《若干意见》、《通知》所规定的条件

1、股份公司目前的经营范围为“研究、开发、设计、制造以下产品：集成电路；各种半导体零组件，包括混合电路（HYBRID CIRCUIT）、集成电路（IC）卡及电路模块；微处理器、外围支持之零组件及系统产品，包括密着型影像传感器（CIS）、液晶显示器（LCD）；半导体记忆体记忆零组件及其系统产品；太阳能电池及其相关之系统模组与产品；集成电路测试与包装；光罩制作。在国内外销售本公司的产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；以及相关半导体工程设计咨询、工程管理咨询、经营管理咨询及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，其经营范围符合《指导外商投资方向规定》与《外商投资产业指导目录（2017年修订）》等外商投资产业政策，符合《若干意见》及《通知》的规定。

2、股份公司目前总股数为3,205,014,276股股份，橡木联合为股份公司外资股东，目前持有股份公司3,145,245,700股股份，占股份公司总股本的98.1352%，股份公司本次拟发行新股股份数的上限为4亿股，股份公司本次发行完成后，外资股东所持股份占股份公司本次发行完成后总股本的比例不低于10%，符合《若干意见》的规定。

3、股份公司为在原有限责任公司和舰有限公司的基础上整体变更以发起设立方式设立的股份有限公司，股份公司设立取得得苏州工业园区行政审批局出具苏园经备201800745号《外商投资企业变更备案回执》，股份公司为按规定和程序设立的企业，符合《通知》的规定。

本所律师认为，股份公司本次发行符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》、《若干意见》、《通知》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、股份公司的设立

本所律师核查了股份公司及其前身和舰有限公司的设立申请文件、历次变更申请文件、历次验资报告、发起人协议书、章程及章程修正案、股东会（股东大会）决议、股权转让协议、历年的营业执照及年检资料等全套工商登记档案；对于影响本所律师作出独立判断而工商部门未要求股份公司提供的资料，本所律师以书面尽职调查清单的形式要求股份公司补充提供了其内部管理的相关档案资料。在此基础上，本所律师对股份公司的设立过程是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规和规范性文件的规定予以验证。

（一）本所律师认为，股份公司设立的程序、资格、条件、方式符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到了有权部门的批准。

（二）本所律师认为，股份公司发起人为设立股份公司所签订的《发起人协议书》符合法律、法规及规范性文件规定，股份公司设立行为不存在潜在纠纷。

（三）本所律师认为，股份公司设立过程中有关审计、评估、验资等已履行必要程序，符合当时法律、法规及规范性文件的规定。

（四）本所律师认为，股份公司设立时股东大会的程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

五、股份公司的独立性

本所律师核查了发行人按照本所书面尽职调查清单提供的文件资料（包括但不限于资产资料、业务资料、人员资料、财务资料、机构资料、发行人股东、董

事、监事及高级管理人员签署的尽职调查问卷、发行人出具的声明与承诺), 协助发行人建立董事会、监事会及董事会下属专门委员会并进一步完善业务职能部门, 对发行人的经营办公场地进行了实地查验; 在此基础上, 本所律师对发行人的独立性是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

(一) 根据股份公司提供的资料、出具的声明与承诺并经本所律师核查, 股份公司目前的经营范围为“研究、开发、设计、制造以下产品: 集成电路; 各种半导体零组件, 包括混合电路 (HYBRID CIRCUIT)、集成电路 (IC) 卡及电路模块; 微处理器、外围支持之零组件及系统产品, 包括密着型影像传感器 (CIS)、液晶显示器 (LCD); 半导体记忆体记忆零组件及其系统产品; 太阳能电池及其相关之系统模组与产品; 集成电路测试与包装; 光罩制作。在国内外销售本公司的产品并提供相关服务; 从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理 (拍卖除外) 及相关业务; 以及相关半导体工程设计咨询、工程管理咨询、经营管理咨询及相关配套服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。”股份公司拥有从事上述业务所必需的生产设施和条件, 能够独立支配和使用人、财、物等生产要素, 自主作出经营决策, 顺利组织和实施生产经营活动。股份公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

(二) 根据股份公司提供的资料、出具的声明与承诺并经本所律师核查, 股份公司属于生产型企业, 具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施, 合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备的所有权或者使用权以及注册商标、专利所有权、集成电路布图设计、非专利技术等资产的所有权或者使用权, 具有独立的原料采购和产品销售系统。股份公司资产完整。

(三) 根据股份公司提供的资料、出具的声明与承诺并经本所律师核查, 股份公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 截至本法律意见书出具之日, 股份公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业领薪; 股份公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。股份公司人员独立。

(四) 根据股份公司提供的资料、出具的声明与承诺并经本所律师核查, 股份公司已建立独立的财务核算体系, 能够独立作出财务决策, 具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度; 股份公司不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。股份公司财务独立。

(五) 根据股份公司提供的资料、出具的声明与承诺并经本所律师核查, 股份公司目前下设董事会办公室、生产制造处、市场销售处、资材处、厂务暨扩建处、品质暨可靠度保证处、人力资源处、会计暨财务处、风险管理暨安环处、资讯工程处、内部审计处、研究发展处等生产经营和管理部门。股份公司已建立健全内部经营管理机构, 独立行使经营管理职权, 不存在与控股股东及其控制的其他企业间有机构混同的情形。股份公司机构独立。

(六) 根据股份公司提供的资料、出具的声明与承诺并经本所律师核查, 股份公司主要从事 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造业务, 涵盖 28nm、40nm、90nm、0.11 μm 、0.13 μm 、0.18 μm 、0.25 μm 、0.35 μm 、0.5 μm 等制程。根据股份公司提供的资料、股份公司与直接、间接控股股东签署的《避免同业竞争协议》、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939 号《审计报告》及本所律师核查, 股份公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在对股份公司构成重大不利影响的同业竞争, 不存在影响发行人独立性或显失公平的关联交易。股份公司业务独立。

综上所述, 本所律师认为, 股份公司的业务、机构、人员、财务和资产均独立于控股股东及其控制的其他企业, 股份公司具有独立法人资格, 其经营活动在其核准的经营范围内进行, 具备独立完整的业务体系, 具备直接面向市场的独立经营能力及风险承受能力, 股份公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在对股份公司构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易, 股份公司在独立性方面不存在其他严重缺陷。

六、股份公司的发起人或股东

为查验发行人的发起人或股东情况, 本所律师核查了发行人全套工商登记资料, 核查了发行人的发起人或股东提供的注册证书、股份证书、股东名册及相关

公认证文件、营业执照、章程；核查了发行人的发起人或股东出具的声明与承诺；取得了（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》；在此基础上，本所律师对发行人的发起人或股东是否具备《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件规定的资格予以验证。

（一）股份公司为在原有限责任公司一和舰有限公司的基础上整体变更以发起设立方式设立的股份有限公司，股份公司发起人为橡木联合、富拉凯咨询。股份公司上述发起人或股东具有法律、法规及规范性文件规定担任股份公司发起人或股东的主体资格。

（二）股份公司发起人人数、住所、出资比例均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）股份公司为和舰有限公司整体变更以发起方式设立，股份公司的资产产权清晰，和舰有限公司的资产更名至股份公司不存在法律障碍。

（四）股份公司为和舰有限公司整体变更设立，不存在股份公司发起人将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情形。

（五）和舰有限公司拥有的房屋所有权、国有土地使用权、注册商标、专利等资产已由股份公司实际占有、使用，上述资产的权属证书已办理完毕更名手续或正在办理更名手续，上述资产更名至股份公司不存在法律障碍或风险。

（六）和舰有限公司的债权债务由股份公司承继，不存在法律障碍或风险。

（七）股份公司发起人或股东间的关联关系及股份公司发起人或股东与股份公司董事、监事、高级管理人员的关联关系

1、股份公司发起人或股东间不存在关联关系

2、股份公司发起人或股东与股份公司董事、监事、高级管理人员的关联关系

橡木联合现持有股份公司 98.1325%的股权，系股份公司控股股东。晶信科技现持有橡木联合 100%的股权，菁英国际现持有晶信科技 100%的股权，联华电子现持有菁英国际 100%的股权。股份公司董事长洪嘉聪兼任联华电子董事长、策略长，股份公司副董事长、财务负责人尤朝生兼任橡木联合、晶信科技、菁英国际的董事，股份公司董事刘启东兼任联华电子副总经理、财务长，股份公司董事林俊宏兼任菁英国际的董事、联华电子财务处长，股份公司监事会主席王文杰兼任菁英国际董事、联华电子会计处处长。

根据股份公司董事、监事、高级管理人员签署的《尽职调查问卷》、联华电子近三年来披露的公开信息、（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》等资料，截至 2018 年 12 月 31 日，股份公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有联华电子股权情况如下：

姓名	职务或亲属身份	直接持股（股）	信托持股	合计占比
洪嘉聪	董事长	39,916,452	-	0.32128%
黄美卿	董事长洪嘉聪之妻	1,269,435	-	0.01022%
洪维泽	董事长洪嘉聪之子	214,378	-	0.00173%
尤朝生	副董事长兼财务负责人	26,140	-	0.00021%
王慈雯	副董事长兼财务负责人 尤朝生之妻	28,424	-	0.00023%
高明正	董事兼总经理	1,042	-	0.00001%
刘启东	董事	2,440,217	900,000	0.02688%
刘柏希	董事刘启东之子	162,348	-	0.00131%
林俊宏	董事	362	120,000	0.00097%
林光民	董事林俊宏之父	5,000	-	0.00004%
郑婉伶	董事	2,000	-	0.00002%
朱伟杰	董事会秘书	264	-	0.00000%
王文杰	监事会主席	50,000	120,000	0.00137%
朱名均	职工监事	1,224	-	0.00001%
吕宜政	监事	1,500	-	0.00001%
颜瑞卿	监事吕宜政之母	4,381	-	0.00004%
吕文雯	监事吕宜政之二姐	4,381	-	0.00004%
合计		44,127,548	1,140,000	0.35517%

注：信托持股是指通过中国信托商业银行股份有限公司（台湾）间接持有联华电子的股份；2、合计占比是指股份公司的董事、监事、高级管理人员所持联华电子的股份占联华电子 2018 年 12 月 31 日发行股本总额 1,242,431.87 万股的比例。

除前述关联关系外，股份公司发起人或股东与股份公司董事、监事、高级管理人员间不存在其他的关联关系。

(八) 根据股份公司提供的工商登记资料资料、股东的公认证资料、股东工商登记资料、(台湾)普华商务法律事务所出具的《法律意见书》、相关主体签署的声明函及本所律师核查，股份公司现有股东为橡木联合、富拉凯咨询，股份公司现有股东中不存在《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规和自律规则规定的私募投资基金。

(九) 根据发行人的工商登记备案资料、股份公司股东签署的尽职调查问卷、股份公司全体股东签署的承诺函并经本所律师核查，股份公司股东目前持有股份公司的股份不存在股权代持或信托持股等变相持股及其他利益安排的情形。

(十) 根据发行人的工商登记备案资料、股份公司股东签署的尽职调查问卷、股份公司全体股东签署的承诺函并经本所律师核查，目前股份公司股东除享有《股份公司章程》所明确之股东权益、承担义务以外，不存在以口头约定或者签署补充书面协议等任何方式，另行与股份公司或其他股东、董事、监事、高级管理人员之间协商确定涉及股东权利再次分配或者影响股份公司股权结构稳定性之任何其他协议或安排(包括但不限于：针对优先分红权、优先清偿权、股份回购权、业绩承诺、股份优先受让权、优先跟卖权、共同出售权、以及约定不同于或者严格于现有《股份公司章程》所明确之股东大会、董事会、监事会的表决方式等)。

(十一) 股份公司无实际控制人

1、股份公司控制权未发生变更

(1) 根据股份公司提供的资料、股份公司的工商登记资料、(台湾)普华商务法律事务所出具的《法律意见书》，截至本法律意见书出具之日，橡木联合持有股份公司 3,145,245,700 股股份，占股份公司本次发行前总股本的 98.1325%，

系股份公司控股股东。晶信科技现持有橡木联合 100%的股权，菁英国际现持有晶信科技 100%的股权，联华电子现持有菁英国际 100%的股权。即联华电子通过菁英国际、晶信科技橡木联合间接持有股份公司 3,145,245,700 股股份，占股份公司本次发行前总股本的 98.1325%。股份公司的直接控股股东为橡木联合，间接控股股东为晶信科技、菁英国际和联华电子，最终控股股东为联华电子。近三年来联华电子通过晶信科技、菁英国际、橡木联合控制路径如下：

根据股份公司提供的资料、股份公司的工商登记资料、（台湾）普华商务律师事务所出具的《法律意见书》及本所律师核查，自 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月期间，橡木联合一直持有和舰有限公司 100%的股权。2018 年 5 月，经和舰有限公司股东橡木联合作出股东决定并经苏州工业园区行政审批局备案，和舰有限公司注册资本由美元变更为人民币，原注册资本美元 3.8 亿元折合人民币 3,145,245,700 元，并将和舰有限公司注册资本由 3,145,245,700 元增至 3,205,014,276 元，和舰有限公司本次新增的 59,768,576 元注册资本均由新股东富拉凯咨询认缴，公司类型由外商独资有限责任公司变更为中外合资经营有限责任公司。橡木联合所持和舰有限公司的股权比例由 100%变更为 98.1352%，2018 年 6 月，和舰有限公司整体变更以发起设立方式设立为股份有限公司，橡木联合持有发行人的股权比例亦为 98.1352%，橡木联合近三年来始终为发行人的控股股东。

根据股份公司提供的资料、股份公司的工商登记资料、（台湾）普华商务律师事务所出具的《法律意见书》及本所律师核查，近三年来，晶信科技始终持有橡木联合 100%的股权，菁英国际始终持有晶信科技 100%的股权，上述股权控制结构未发生变化。

根据股份公司提供的资料、股份公司的工商登记资料、（台湾）普华商务律师事务所出具的《法律意见书》及本所律师核查，2016 年 1 月 1 日，联华电子持有菁英国际 91.08%的股权，2016 年度，经台湾经济部投资审议委员会批准，联华电子通过股权受让方式共计收购 5.24%的股权，联华电子持有菁英国际的股权比例增至 96.32%；2017 年度，经台湾经济部投资审议委员会批准，联华电子通过股权受让方式共计收购 0.35%的股权，联华电子持有菁英国际的股权比例增至 96.67%；2018 年 2 月，经台湾经济部投资审议委员会批准，联华电子通过股

权受赠方式收购 3.33%的股权，至此，联华电子持有菁英国际 100%的股权。根据上述股权变化情况，近三年来联华电子始终为菁英国际的控股股东。

(2) 联华电子成立于 1980 年，其为依据中国台湾法律设立且合法有效存续并于 1985 年在台湾证券交易所上市（股票代码为 2303）、2000 年在纽约证券交易所发行 ADR（股票代码 UMC）的股份有限公司。根据股份公司提供的资料、股份公司的工商登记资料、（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》、联华电子近三年来披露的公开信息，联华电子股权结构分散，单一股东无法控制联华电子的股东大会和董事会，联华电子无实际控制人。

综上，股份公司的控制结构最近三年没有发生重大变化。根据（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》及本所律师核查，股份公司上述架构层架设置的原因为：因两岸关系问题，中国台湾居民对大陆的投资通常采用在中国境外设立第三地公司，再通过设立于中国境外的第三地公司对大陆进行直接投资的模式。

2、经营管理层和主营业务在最近三年没有发生重大变化

(1) 根据股份公司的说明、股份公司的工商登记资料、股份公司董事、监事、高级管理人员填写《尽职调查问卷》及其简历并经本所律师登入“国家企业信用信息公示系统”对股份公司的核查，股份公司董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况如下：

截至 2016 年 1 月 1 日，和舰有限公司董事会成员为尤朝生、蔡在二、朱伟杰，尤朝生为董事长，监事为王文杰，总经理为高明正、财务负责人为朱伟杰。

2016 年 4 月 26 日，和舰有限公司董事会作出决议，同意原董事蔡在二任期届满并解任，委任林俊宏为和舰有限公司新的董事。

2017 年 3 月 1 日，和舰有限公司董事会作出决议，免去朱伟杰的董事职务，委派周大任为和舰有限公司新的董事。

2018年6月21日，股份公司召开创立大会暨第一股东大会，选举洪嘉聪、尤朝生、高明正、刘启东、郑婉伶、林俊宏、安庆衡、林凤仪、郭田勇为股份公司第一届董事会成员，任期三年。其中，安庆衡、林凤仪、郭田勇为股份公司独立董事。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举洪嘉聪为股份公司董事长、尤朝生为股份公司副董事长，聘任高明正为股份公司总经理，聘任尤朝生为股份公司财务负责人，聘任朱伟杰为股份公司董事会秘书，聘任林伟圣为股份公司副总经理。

2018年6月20日，股份公司召开职工代表大会，选举朱名均为职工代表监事。2018年6月21日，股份公司召开创立大会暨第一股东大会，选举王文杰、吕宜政为股份公司股东代表监事，与职工代表监事朱名均共同组成第一届监事会。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举王文杰为股份公司第一届监事会主席。

2018年9月25日，股份公司召开2018年第一次临时股东大会，因郭田勇个人原因辞任股份公司独立董事职务，同意补选张文丽为股份公司新的独立董事。

综上，股份公司的董事、监事、高级管理人员最近三年没有发生重大变化。

(2) 根据股份公司的说明、股份公司的工商登记资料、营业执照并经本所律师登入“国家企业信用信息公示系统”对股份公司的查询，股份公司最近三年的经营范围一直为“研究、开发、设计、制造以下产品：集成电路；各种半导体零组件，包括混合电路（HYBRID CIRCUIT）、集成电路（IC）卡及电路模块；微处理器、外围支持之零组件及系统产品，包括密着型影像传感器（CIS）、液晶显示器（LCD）；半导体记忆体记忆零组件及其系统产品；太阳能电池及其相关之系统模组与产品；集成电路测试与包装；光罩制作。在国内外销售本公司的产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；以及相关半导体工程设计咨询、工程管理咨询、经营管理咨询及相关配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，股份公司主要从事12英寸及8英寸晶圆研发制造业务，涵盖28nm、40nm、90nm、0.11 μm 、0.13 μm 、0.18 μm 、0.25 μm 、0.35 μm 、0.5 μm 等制程。

综上，股份公司的主营业务最近三年没有发生重大变化。

3、股份公司的股权及控制结构不影响公司治理有效性

经本所律师对股份公司的董事会、股东大会会议文件、制度文件的核查，股份公司已经依法建立健全股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，股份公司设立的上述组织机构及其相关人员依据法律法规及《公司章程》等制度履行职责，股份公司无实际控制人的情形不影响股份公司治理的有效性。

4、股份公司股东采取股份锁定等有利于股份公司股权及控制机构稳定的措施

股份公司控股股东橡木联合、晶信科技、菁英国际、联华电子均出具《关于控股股东自愿锁定股份的承诺》，承诺“自和舰芯片股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有和舰芯片的首次公开发行前的股份，也不得提议由和舰芯片回购该部分股份；在和舰芯片实现盈利前，自和舰芯片股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理橡木联合、晶信科技、菁英国际、联华电子在和舰芯片上市之前直接或间接持有的和舰芯片股份，也不由和舰芯片回购橡木联合、晶信科技、菁英国际、联华电子在和舰芯片上市之前直接或间接持有的和舰芯片股份。自和舰芯片股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的首次公共发行前股份不得超过和舰芯片股份总数的 2%。橡木联合、晶信科技、菁英国际、联华电子在和舰芯片上市之前直接或间接所持和舰芯片股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；和舰芯片上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，橡木联合、晶信科技、菁英国际、联华电子在和舰芯片上市之前直接或间接持有和舰芯片股票的锁定期自动延长 6 个月”。

综上，本所律师认为，股份公司不存在实际控制人的认定符合《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用—证券期货法律适用意见第 1 号》的规定。

七、股份公司的股本及其演变

为查验发行人的股本及其演变情况，本所律师核查了发行人及其前身和舰有限公司的设立申请文件、历次变更申请文件、历次验资报告、相关主管部门出具的批准、批复文件、外商投资企业批准证书、股权（出资）转让协议、发起人协议书、历次章程及章程修正案、股东大会决议、营业执照等全套工商登记档案；对于影响本所律师作出独立判断而工商部门未要求发行人提供的资料，本所律师以书面尽职调查清单的形式要求发行人补充提供其内部管理的相关档案资料；在此基础上，本所律师对发行人的股本及其演变是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

股份公司为在原有限责任公司一和舰有限公司的基础上整体变更以发起设立方式设立的股份有限公司。和舰有限公司成立于 2001 年 11 月 23 日，其设立时注册资本为 3.5 亿美元，系由投资联盟独资设立的外商独资有限公司。2002 年 4 月，投资联盟将其持有和舰有限公司的 100%股权转让给橡木联合；2004 年 6 月，和舰有限公司的注册资本由 3.5 亿美元增至 4.5 亿美元；2008 年 11 月，和舰有限公司的注册资本由 4.5 亿美元减至 3.8 亿美元；2018 年 5 月，和舰有限公司注册资本由 3.8 亿美元增至人民币 3,205,014,276，并变更为中外合资企业，2018 年 6 月，和舰有限公司整体变更发起设立为股份公司，并更名为和舰芯片制造（苏州）股份有限公司。具体情况如下：

（一）和舰有限公司的设立、历次注册资本及股权变化情况

1、和舰有限公司的设立

2001 年 11 月 22 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具（苏园）名称预核字[2001]第 1398 号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“和舰科技（苏州）有限公司”。

2001 年 11 月 22 日，苏州工业园区管理委员会出具苏园管复字[2001]130 号《关于设立外商独资“和舰科技（苏州）有限公司”的批复》，同意投资联盟独资设立“和舰科技（苏州）有限公司”，投资总额为 10 亿美元，注册资本为 3.5

亿美元，全部以现汇入资；自营业执照签发之日 90 天内注入 15%，剩余 85%自营业执照签发之日 5 年内到位。

2001 年 11 月 23 日，和舰有限公司取得江苏省人民政府颁发的批准号为外经贸苏府资字[2001]36911 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。同日，和舰有限公司取得江苏省工商行政管理局颁发的注册号为企独苏总字第 020702 号《企业法人营业执照》，住所为苏州工业园区苏春路，法定代表人为徐建华，注册资本为 35,000 万美元（实收资本为 0），企业类型为外商独资经营，经营范围为“研究、开发、设计、制造以下产品：集成电路：各种半导体零组件，包括混合电路（Hybrid circuit）、集成电路（IC）卡机电路模块；微处理器、微处理器、外围支持之零组件及系统产品，包括密着型影像传感器（CIS）、液晶显示器（LCD）；半导体记忆体记忆零组件及其系统产品；集成电路测试与包装；光罩制作。在国外销售本公司的产品并提供相关服务”。和舰有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
投资联盟	35,000 万美元	0	100%

本所律师认为，和舰有限公司的设立符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，真实、合法。

2、2002 年 4 月，第一次股权转让

2002 年 1 月 23 日，投资联盟向和舰有限公司缴纳 1,499,990 美元出资款。

2002 年 3 月 15 日，和舰有限公司召开董事会，同意投资联盟将对和舰有限公司的所有权和经营权全部转让予橡木联合。同日，投资联盟与橡木联合就前述股权转让事宜签署《转让协议》。

2002 年 3 月 20 日，苏州工业园区管理委员会出具苏园管复字[2002]24 号《关于和舰科技（苏州）有限公司变更投资方的批复》，同意和舰有限公司的投资方变更为橡木联合。原投资方投资联盟拥有和舰有限公司的股权、权利和义务全部

转让给橡木联合。

2002年4月6日，和舰有限公司取得江苏省人民政府换发的批准号为外经贸苏府资字[2002]36911号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2002年4月8日，和舰有限公司在江苏省工商行政管理局办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续，并取得换发的注册号为企独苏总字第020702号的《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后，和舰有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
橡木联合	35,000 万美元	1,499,990 美元	100%

本所律师认为，和舰有限公司上述股权转让行为符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，真实、合法。

3、和舰有限公司设立时注册资本到位情况

2002年11月28日，苏州方本会计师事务所有限公司出具方会资字（2002）第256号《验资报告》，经审验，截至2002年11月26日，和舰有限公司已收到原股东投资联盟缴纳1,499,990美元出资和现股东橡木联合缴纳58,500,010美元出资，共计6,000万美元，均为货币出资，占和舰有限公司注册资本的17.14%。

2003年2月20日，苏州方本会计师事务所有限公司出具方会资字（2003）第035号《验资报告》，经审验，截至2003年2月12日，和舰有限公司已收到股东橡木联合缴纳的第二期出资3,500万美元，均为货币出资。截至2003年2月12日，和舰有限公司的注册资本为3.5亿美元，实收资本为9,500万美元（占注册资本的27.14%）。

2003年8月26日，苏州方本会计师事务所有限公司出具方会资字（2003）第226号《验资报告》，经审验，截至2003年6月11日，和舰有限公司已收到股东橡木联合缴纳的第三期出资14,000万美元，均为货币出资。截至2003年6月11日，和舰有限公司的注册资本为3.5亿美元，实收资本为23,500万美元（占

注册资本的 67.14%)。

2004 年 6 月 14 日,苏州方本会计师事务所有限公司出具方会外资字(2004)第 114 号《验资报告》,验证截至 2004 年 5 月 26 日,和舰有限公司已收到股东橡木联合缴纳的第四期出资 11,500 万美元,均为货币出资。截至 2004 年 5 月 26 日,和舰有限公司的注册资本为 3.5 亿美元,实收资本为 3.5 亿美元(占注册资本的 100%)。

经本所律师核查,和舰有限公司收到股东缴纳的第一期 6,000 万美元出资中有 1,499,990 美元系原股东投资联盟于 2001 年 1 月 23 日汇入和舰有限公司,另外 58,500,010 美元为橡木联合于 2002 年 4 月 23 日至 2002 年 11 月 26 日分七次汇入和舰有限公司。橡木联合对和舰有限公司设立时首期出资超过《外资企业法实施细则》(2001)和《关于设立外商独资“和舰科技(苏州)有限公司”的批复》所规定的“自营业执照签发之日 90 天内注入 15%”的期限。鉴于工商主管部门及商务审批部门未给予其行政处罚,且和舰有限公司于 2002 年 12 月 25 日取得江苏省工商行政管理局换发的注册号为企独苏总字第 020702 号的《企业法人营业执照》,证实其首期注册资本业已缴足。本所律师认为,前述事项对和舰有限公司主体资格合法有效存续不构成实质性障碍。

4、2004 年 6 月,和舰有限公司注册资本由 3.5 亿美元增至 4.5 亿美元

2004 年 5 月 27 日,和舰有限公司召开董事会,同意将注册资本由 3.5 亿美元增至 4.5 亿美元,本次增资全部由原投资方橡木联合以现汇方式出资。

2004 年 6 月 17 日,苏州工业园区管理委员会出具苏园管复字[2004]144 号《关于和舰科技(苏州)有限公司增资的批复》,同意和舰有限公司新增注册资本 1 亿美元,全部以现汇出资,注册资本由 3.5 亿美元增至 4.5 亿美元。新增注册资本的 15%应在新的营业执照颁发之日起三个月内出资到位,其余部分在新的营业执照颁发之日起三年内全部出资到位。

2004 年 6 月 17 日,和舰有限公司取得江苏省人民政府换发的批准号为商外资苏府资字[2004]36911 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,投资人

为橡木联合。

2004年6月22日，和舰有限公司在江苏省工商行政管理局办理完毕上述增资的工商变更登记手续，并取得换发的注册号为企独苏总字第020702号的《企业法人营业执照》，注册资本为4.5亿美元，实收资本为3.5亿美元。

2005年1月22日，苏州方本会计师事务所出具方会外资字(2005)第1003号《验资报告》，经审验，截至2005年1月22日，和舰有限公司已收到股东橡木联合缴纳的3,000万美元出资，均为货币出资。截至2005年1月22日，和舰有限公司的注册资本为4.5亿美元，实收资本为3.8亿美元(占注册资本的84.44%)。本次实收资本缴纳完成后，和舰有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资	实缴出资	认缴出资比例
橡木联合	45,000 万美元	38,000 万美元	100%

本所律师认为，和舰有限公司上述增资行为符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

5、2008年11月，和舰有限公司注册资本由4.5亿美元减至3.8亿美元

2008年9月1日，和舰有限公司股东作出决定，同意将和舰有限公司的注册资本由4.5亿美元减至3.8亿美元。2008年9月9日，和舰有限公司在《苏州日报》刊登前述减资的公告。

2008年10月25日，苏州工业园区管理委员会出具苏园管复字[2008]201号《关于和舰科技(苏州)有限公司减少注册资本的批复》，同意和舰有限公司的注册资本由4.5亿美元减至3.8亿美元。

2008年10月29日，和舰有限公司取得江苏省人民政府换发的批准号为商外资字苏府资字[2008]36911号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2008年11月6日，和舰有限公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办

理完毕上述减资的工商变更登记手续，并取得换发的注册号为 320594400003221 的《企业法人营业执照》，注册资本为 3.8 亿美元。本次减资完成后，和舰有限公司的股权结构为：

股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
橡木联合	38,000 万美元	38,000 万美元	100%

本所律师认为，和舰有限公司上述减资行为符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，真实、合法。

6、2018 年 5 月，和舰有限公司注册资本增至人民币 3,205,014,276 元暨变更为中外合资企业

2018 年 5 月 11 日，和舰有限公司股东作出决定，同意和舰有限公司注册资本由美元变更为人民币，按照出资到位时的历史汇率计算，原注册资本美元 3.8 亿元折合人民币 3,145,245,700 元；同意将和舰有限公司注册资本由 3,145,245,700 元增至 3,205,014,276 元，和舰有限公司本次新增的 59,768,576 元注册资本均由新股东富拉凯咨询认缴，增资价格为 2.0914 元/出资，认缴期限为 2018 年 12 月 31 日；同意将公司类型由外商独资有限责任公司变更为中外合资经营有限责任公司。

富拉凯咨询本次认缴增资价格约为和舰有限公司 2018 年 3 月 31 日每股净资产的 1.5 倍，此价格为参考与和舰有限公司相似业务的上市公司 2018 年 3 月 31 日的市净率的基础上经协商确定。

2018 年 5 月 15 日，和舰有限公司在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理完毕上述增资暨公司类型变更的工商变更登记手续，并取得换发的统一社会信用代码为 91320594732513557J 的《营业执照》，注册资本为 320,501.4276 万元。

2018 年 5 月 16 日，和舰有限公司取得苏州工业园区行政审批局出具苏园经备 201800512 号《外商投资企业变更备案回执》，苏州工业园区行政审批局对和舰有限公司本次增资、变更为中外合资企业予以备案。

2018年5月29日，大华会计师事务所出具大华验字[2018]000304号《验字报告》，经审验，截至2018年5月28日，和舰有限公司已收到股东富拉凯咨询缴纳的125,000,000元投资款，其中59,768,576元为注册资本，其余的65,231,424元计入资本公积，均为货币出资。截至2018年5月28日，和舰有限公司注册资本为320,501.4276万元，实收资本为320,501.4276万元（占注册资本的100%）。

本次增资完成后，和舰有限公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资	实缴出资	出资比例
1	橡木联合	3,145,245,700元	3,145,245,700元	98.1352%
2	富拉凯咨询	59,768,576元	59,768,576元	1.8648%
合计		3,205,014,276元	3,205,014,276元	100.00%

本所律师认为，和舰有限公司上述增资暨变更为中外合资企业的行为符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

（二）股份公司设立时的股权设置和股本结构

股份公司为在原有限责任公司—和舰有限公司的基础上整体变更以发起设立方式设立的股份有限公司。和舰有限公司截至2018年5月31日的经审计的净资产为4,997,067,872.23元，按1:0.6414比例折股为股本3,205,014,276股，大于股本部分1,792,053,596.23元计入资本公积金。股份公司成立时股本总额为3,205,014,276股，股份公司成立时发起人的持股数量及持股比例如下：

编号	发起人股东名称	注册地	持股数（股）	持股比例
1	橡木联合	英属维尔京群岛	3,145,245,700	98.1352%
2	富拉凯咨询	中国上海	59,768,576	1.8648%
总计			3,205,014,276	100.0000%

本所律师认为，股份公司设立时的股权设置和股本结构合法、有效；发起人上述持股数量及持股比例已在《股份公司章程》中载明且已在工商登记机关登记，其产权界定和确认不存在任何纠纷及风险。

（三）根据股份公司提供的资料并经本所律师核查，股份公司设立后至今，股份公司的股本及发起人所持股份公司股份未发生任何变动。

（四）根据发行人的工商登记备案资料、股份公司股东签署的尽职调查问卷、股份公司全体股东签署的承诺函并经本所律师核查，股份公司股东目前持有股份公司股份真实、合法，不存在任何质押、被司法机关冻结等导致其行使股东权利受到限制的情形；且未有针对股东持有股份公司股份所产生的任何法律纠纷，亦不存在发生潜在纠纷的可能。

八、股份公司的业务

为查验发行人的业务开展情况，本所律师核查了发行人的《营业执照》、《股份公司章程》、设立至今工商登记资料、《审计报告》、发行人出具的声明与承诺，并研究了与发行人主营业务有关的国家产业政策的规定；在此基础上，本所律师对发行人的业务经营、主营业务变化及持续经营情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）股份公司目前的经营范围为“研究、开发、设计、制造以下产品：集成电路；各种半导体零组件，包括混合电路（HYBRID CIRCUIT）、集成电路（IC）卡及电路模块；微处理器、外围支持之零组件及系统产品，包括密着型影像传感器（CIS）、液晶显示器（LCD）；半导体记忆体记忆零组件及其系统产品；太阳能电池及其相关之系统模组与产品；集成电路测试与包装；光罩制作。在国内外销售本公司的产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；以及相关半导体工程设计咨询、工程管理咨询、经营管理咨询及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。经营方式为研发、生产、销售。经本所律师核查，上述经营范围符合《指导外商投资方向规定》与《外商投资产业指导目录（2017年修订）》等外商投资产业政策。股份公司所从事业务符合《股份公司章程》和

《营业执照》规定的经营范围，与其法定行为能力一致，其经营范围与经营方式符合有关法律、法规和规范性文件规定。

（二）发行人大陆以外经营情况

根据大华会计师事务所出具大华审字[2019]001939号《审计报告》、发行人出具的书面确认文件，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人未在中国大陆以外的国家和地区直接经营业务。

（三）股份公司近三年来主营业务未发生变更

根据发行人近三年来的工商登记资料及本所律师核查，发行人近三年来的经营范围未发生过变更，发行人主要从事 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造业务，涵盖 28nm、40nm、90nm、0.11 μm 、0.13 μm 、0.18 μm 、0.25 μm 、0.35 μm 、0.5 μm 等制程，发行人的主营业务未发生变更。

（四）股份公司主营业务突出

根据大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》股份公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的主营业务收入分别为 184,587.73 万元、323,579.19 万元、357,062.44 万元，均占股份公司营业总收入的 90%以上；股份公司的主营业务突出。

（五）股份公司不存在持续经营的法律障碍

根据大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》股份公司出具的声明与承诺并经本所律师核查，截至目前，股份公司有效存续，生产经营正常，没有受到相关政府主管部门的重大行政处罚，不存在法律、法规、规范性文件及《股份公司章程》规定的导致无法持续经营的情形，本所律师认为，股份公司持续经营不存在法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

为查验发行人的关联交易和同业竞争情况，本所律师按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《编报规则 12 号》等法律法规及规范性文件的有关规定确认了发行人的关联法人，核查了发行人关联法人的《营业执照》、《章程》、股份公司董事、监事、高级管理人员签署的尽职调查问卷、发行人近三年与关联方签订的关联交易合同或协议、相关关联交易往来财务凭证、独立董事关于发行人最近三年关联交易的独立意见、发行人股东签署的尽职调查问卷、出具的《关于避免同业竞争事项的承诺》、签署的《避免同业竞争协议》、发行人有关规范关联交易的相关三会及内部控制制度文件及大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939 号《审计报告》等资料。在此基础上，本所律师对发行人的关联交易及同业竞争是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）股份公司的关联方

根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市规则》、《编报规则 12 号》等法律法规及规范性文件的有关规定，股份公司的关联方包括：

1、持有股份公司 5%以上股份的股东为股份公司的关联方

根据《股份公司章程》及本所律师审查，目前直接持有股份公司 5%以上股份的股东为橡木联合，橡木联合为股份公司的关联方。

股份公司间接控股股东晶信科技、菁英国际、联华电子亦为股份公司的关联方。

2、股份公司目前拥有的下属子公司、参股企业为股份公司关联方

关联方名称	持股比例	主要从事的业务
厦门联芯	股份公司子公司，股份公司持股 14.49%	主要从事 12 英寸专业晶圆代工服务，涵盖 28nm、40nm、90nm 等制程

山东联璟	股份公司子公司，股份公司持股 100%	主要从事 IC 设计服务业务
厦门联和	厦门联芯参股企业，厦门联芯持股 9.705%	主要从事投资业务

3、股份公司目前的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为股份公司的关联方。关系密切的家庭成员包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

序号	关联方姓名	在股份公司担任的职务
1	洪嘉聪	股份公司董事长
2	尤朝生	股份公司副董事长、财务负责人
3	高明正	股份公司董事、总经理
4	刘启东	股份公司董事
5	郑婉伶	股份公司董事
6	林俊宏	股份公司董事
7	安庆衡	股份公司独立董事
8	林凤仪	股份公司独立董事
9	张文丽	股份公司独立董事
10	王文杰	股份公司监事会主席
11	朱名均	股份公司监事
12	吕宜政	股份公司监事
13	朱伟杰	股份公司董事会秘书
14	林伟圣	股份公司副总经理

股份公司目前的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或有重大影响的除股份公司及其下属子公司外的企业为股份公司的关联方。

序号	关联方名称	关联关系
1	联华电子	股份公司董事长洪嘉聪担任该企业董事长、股份公司董事刘启东担任该企业副总经理兼财务长
2	济南泰韵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股份公司董事长洪嘉聪出资 46.67%并担任普通合伙人的企业
3	宏诚投资	股份公司董事长洪嘉聪担任该企业董事长、股份公司董事刘启东担任该企业董事
4	智原科技	股份公司董事长洪嘉聪担任该企业董事长
5	智原科技（上海）有限公司	股份公司关联方智原科技控制的子公司
6	智原微电子（苏州）有限公司	
7	寅通科技股份有限公司	
8	士鼎创业投资股份有限公司	股份公司董事长洪嘉聪担任该企业董事
9	United Microelectronics (Europe) B. V.	股份公司董事长洪嘉聪担任该企业董事
10	UMC Capital Corp.	股份公司董事长洪嘉聪担任该企业董事长、股份公司董事刘启东担任该企业的董事
11	UMC Capital (USA)	股份公司董事长洪嘉聪担任该企业董事
12	弘鼎投资	股份公司董事长洪嘉聪担任该企业董事长、股份公司董事刘启东担任该企业的董事、股份公司董事林俊宏担任该企业监察人
13	橡木联合	股份公司董事尤朝生担任该企业的董事
14	晶信科技	股份公司董事尤朝生担任该企业的董事
15	菁英国际	股份公司董事尤朝生、董事林俊宏、监事会主席王文杰担任该企业的董事
16	冠铨香港股份有限公司	股份公司董事尤朝生、林俊宏担任董事的企业
17	UMC Technology Japan Co., Ltd.	股份公司董事刘启东、林俊宏担任该企业董事
18	联相光电	股份公司董事林俊宏担任董事的企业
19	联旭能源	
20	永盛香港	
21	迅捷投资	
22	美国联电	股份公司董事刘启东担任董事的企业
23	Sino Paragon Limited	
24	联华微芯	
25	联咏科技	
26	绿色星球	
27	ECP Vita Pte. Ltd.	

28	OMNI	
29	UMC Technology Japan Co., Ltd.	
30	UNITED MICROTECHNOLOGY CORPORATION (CALIFORNIA)	
31	UNITED MICROTECHNOLOGY CORPORATION (NEW YORK)	
32	欣兴电子	
33	三重富士通	
34	矽统科技	股份公司董事郑婉伶担任该企业监事、股份公司监事会主席王文杰担任该企业的董事

4、股份公司控股股东目前控制的除股份公司及其下属子公司外的企业为股份公司的关联方

序号	关联方名称	联华电子持股情况
1	美国联电	联华电子持股 100%
2	日本联电	联华电子持股 100%
3	UNITED MICROELECTRONICS (EUROPE) B. V.	联华电子持股 100%
4	UMC CAPITAL CORP.	联华电子持股 100%
5	绿色星球	联华电子持股 100%
6	弘鼎投资	联华电子持股 100%
7	UMC INVESTMEN (SAMOA) LIMITED	联华电子持股 100%
8	宏诚投资	联华电子持股 100%
9	UMC KOREA CO., LTD.	联华电子持股 100%
10	OMNI	联华电子持股 100%
11	SINO PARAGON LIMITED	联华电子持股 100%
12	联相光电	联华电子、宏诚投资、弘鼎投资合计持股 93.36%
13	联颖光电	联华电子、宏诚投资合计持股 78.47%
14	UMC CAPITAL (USA)	联华电子子公司 UMC CAPITAL CORP. 持股 100%
15	SOARING CAPITAL CORP.	联华电子子公司弘鼎投资持股 100%
16	真宏企业管理顾问(上海)有限公司	联华电子孙公司 SOARING CAPITAL CORP. 持股 100%
17	联华微芯	联华电子子公司绿色星球持股 100%

18	联旭能源	联华电子子公司宏诚投资持股 100%
19	永盛香港	联华电子孙公司联旭能源持股 100%
20	永盛山东	联华电子曾孙公司永盛香港持股 100%
21	UNITED MICROTECHNOLOGY CORPORATION (NEW YORK)	联华电子子公司 OMNI 持股 100%
22	UNITED MICROTECHNOLOGY CORPORATION (CALIFORNIA)	联华电子子公司 OMNI 持股 100%
23	ECP VITA PTE. LTD.	联华电子子公司 OMNI 持股 100%
24	UMC TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD.	联华电子子公司 OMNI 持股 100%
25	联颖光电投资	联华电子子公司联颖光电持股 100%
26	WAVETEK MICROELECTRONICS CORPORATION (USA)	联华电子孙公司联颖光电投资持股 100%
27	SOCIALNEX ITALIA 1 S. R. L.	联华电子子公司联相光电持股 100%

5、股份公司控股股东目前担任法人董事的企业为股份公司的关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	联咏科技	联华电子持股 2.7%并担任其法人董事
2	士鼎创业投资股份有限公司	联华电子持股 40%并担任其法人董事
3	联阳半导体	联华电子持股 8.66%并担任其法人董事

6、股份公司控股股东目前董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为股份公司的关联方。关系密切的家庭成员包括：配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

序号	关联方名称	在股份公司控股股东担任的职务
1	洪嘉聪	联华电子的董事长
2	黄振丰	联华电子的独立董事
3	朱文仪	联华电子的独立董事
4	徐爵民	联华电子的独立董事
5	陈力俊	联华电子的独立董事
6	刘炯朗	联华电子的董事

7	林庭裕	联华电子的董事
8	迅捷投资	联华电子的法人董事(代表人: 简山杰)
9	矽统科技	联华电子的法人董事(代表人: 王石)
10	简山杰	联华电子的总经理
11	王石	联华电子的总经理
12	徐明志	联华电子的资深副总经理
13	刘启东	联华电子的副总经理兼财务长
14	张振伦	联华电子的资深副总经理
15	尤朝生	橡木联合、晶信科技、菁英国际的董事
16	王文杰	菁英国际的董事
17	陈进双	菁英国际的董事
18	林俊宏	菁英国际的董事

股份公司控股股东目前的董事(不包括独立董事)、监事和高级管理人员(同时担任股份公司董事、监事、高级管理人员除外)及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的,或有重大影响的除股份公司及其下属子公司外企业为股份公司的关联方。

序号	关联方名称	关联关系
1	集邦科技股份有限公司	联华电子董事刘炯朗担任董事长的企业
2	台扬科技股份有限公司	联华电子董事刘炯朗担任独立董事的企业
3	力晶科技股份有限公司	
4	远传电信股份有限公司	
5	智邦科技股份有限公司	
6	旺宏电子股份有限公司	联华电子董事刘炯朗担任董事的企业
7	联亚药业股份有限公司	
8	究心公益科技股份有限公司	
9	三禄贸易股份有限公司	联华电子董事林庭裕担任董事长的企业
10	MARS INVESTMENTS (SAMOA) LTD	联华电子法人董事矽统科技持股 100%的企业
11	翰硕电子股份有限公司	联华电子法人董事矽统科技担任法人董事的企

12	高尔科技股份有限公司	业
13	亚太优势微系统股份有限公司	
14	原相科技	联华电子法人董事迅捷投资担任法人董事的企业
15	中强光电股份有限公司	
16	宏齐科技股份有限公司	
17	风尚数位科技股份有限公司	
18	英柏得科技股份有限公司	
19	UNITED MICROELECTRONICS (Europe) B.V.	联华电子总经理王石担任该企业董事
20	UNITED MICROT TECHNOLOGY CORPORATION (NEW YORK)	
21	UNITED MICROT TECHNOLOGY CORPORATION (CALIFORNIA)	
22	美国联电	
23	Sino Paragon Limited	
24	宏诚投资	联华电子总经理简山杰、王石担任该企业的董事
25	弘鼎投资	
26	UMC CAPITAL CORP.	
27	联颖光电	
28	晶元光电股份有限公司	联华电子总经理简山杰担任该企业的董事
29	ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR LIMITED	联华电子资深副总经理张振伦担任董事的企业
30	REEBOTIC INC.	

7、其他的关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	张俊彦	联华电子的前独立董事，2017年1月卸任
2	颜博文	联华电子的前执行长，于2017年9月卸任
3	柯彼得	联华电子的前资深副总经理兼法务长，于2017年3月卸任
4	周大任	2017年2月21日至2018年6月20日担任和舰有限公司的董事
5	蔡在二	报告期初至2016年4月25日担任和舰有限公司的董事
6	郭田勇	2018年6月21日至2018年9月25日担任股份公司的独立董事
7	黄柏文	报告期初至2018年11月9日担任菁英国际的董事

8	陈正坤	2015年9月16日至2018年10月15日担任联华电子的资深副总经理
9	FORTEMEDIA, INC	股份公司董事尤朝生从2013年1月至2018年4月担任董事的企业
10	华鸿(山东)能源投资有限公司	联华电子子公司弘鼎投资持股50%的企业, 2018年6月弘鼎投资将该股权全部转让。股份公司董事尤朝生自2015年11月至2018年6月担任该企业董事。
11	济宁华瀚光伏能源有限公司	联华电子原合营子公司华鸿(山东)能源投资有限公司持股100%的企业, 股份公司董事尤朝生自2015年6月至2018年7月担任该企业的董事。
12	财团法人联华电子科技文教基金会	报告期初至2018年6月11日担任联华电子的法人董事
13	台湾水泥股份有限公司	股份公司董事林俊宏的近亲属担任总经理的企业
14	富翔巨川有限公司(台湾)	股份公司董事会秘书朱伟杰的近亲属担任总经理的企业, 该企业已于2018年11月注销。
15	福建晋华	联华电子前资深副总经理陈正坤任总经理的企业
16	联华骐商贸(北京)有限责任公司	联华电子子公司 UMC INVESTMENT (SAMOA) LIMITED 曾持股100%, 于2018年6月注销
17	联电新投资事业股份有限公司	联华电子曾持股100%, 于2018年7月并入联华电子子公司宏诚投资
18	美日光罩	联华电子总经理王石的近亲属担任董事、总经理的企业
19	厦门美日丰创光罩有限公司	美日光罩控制的子公司
20	WINAICO SOLAR PROJEKT 1 GMBH	联华电子子公司联旭能源持股50%
23	盛群半导体	联华电子持股10.90%
24	MTIC HOLDINGS PTE. LTD.	联华电子持股45.44%
25	UNITECH CAPTIAL INC.	联华电子持股42%
26	焱元投资股份有限公司	联华电子持股30.87%
27	UNIMICRON HOLDING LIMITED	联华电子持股17%
28	联福生科技股份有限公司	联华电子持股15.75%
29	公信电子股份有限公司	联华电子子公司宏诚投资持股22.39%
30	达晨创业投资股份有限公司	联华电子子公司宏诚投资持股19.65%
31	盟智科技	联华电子子公司宏诚投资原持股16.02%, 2018年9月宏诚投资将该部分股权全部转让。
32	创科电子股份有限公司	联华电子子公司宏诚投资持股15.93%
33	全盛兴资源科技股份有限公司	联华电子子公司宏诚投资、弘鼎投资合计持股15.14%

34	PIXTECH, INC.	联华电子持股 17.63%
35	HSUN CHIEH Capital Corp.	联华电子子公司弘鼎投资持股 30%
36	永加利医院科技股份有限公司	联华电子子公司弘鼎投资持股 26.89%
37	WINKING ENTERTAINMENT LTD.	联华电子子公司弘鼎投资持股 17.53%
38	BEAUTY ESSENTIALS INTERNATIONAL LTD.	联华电子子公司弘鼎投资持股 13.99%
39	茂鑫能源科技股份有限公司	联华电子子公司宏诚投资持股 15.94%
40	WINAICO IMMOBILIEN GMBH	联华电子子公司宏诚投资和孙公司联旭能源合计持股 44.78%
41	源杰科技股份有限公司	联华电子子公司宏诚投资持股 11.11%
42	建腾创达科技股份有限公司	联华电子子公司宏诚投资和弘鼎投资合计持股 11.39%
43	联致科技股份有限公司	联华电子子公司宏诚投资和弘鼎投资合计持股 13.06%
44	PACIFIC-GREEN INTEGRATED TECHNOLOGY INC.	联华电子子公司联相光电持股 18%
45	咏利创业投资股份有限公司	联华电子子公司弘鼎投资持股 45.16%，该公司已于 2019 年 1 月解散。
46	联京光电	联华电子子公司宏诚投资原持股 83.69%，宏诚投资于 2018 年 12 月将期持有该公司的股权全部转让。
47	济宁一辰房地产开发有限公司	股份公司董事尤朝生在报告期初至 2017 年 1 月担任执行董事的企业

（二）股份公司与关联方之间发生的关联交易

根据股份公司提供的资料、大华会计师事务所出具[2019]001939号《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，股份公司与关联方之间发生的关联交易如下：

1、经常性关联交易

（1）采购货物或服务

①向联华电子及其控制的其他公司采购货物或服务

单位：万元

关联方	交易内容	2018年			2017年			2016年		
		金额	占比	同类交易占比	金额	占比	同类交易占比	金额	占比	同类交易占比
联华电子及其新加坡分公司	材料采购	4,259.04	0.85%	2.95%	3,557.22	0.89%	2.90%	6,422.39	4.26%	6.40%
	接受劳务	1,605.27	0.32%	5.47%	1,239.30	0.31%	5.25%	1,665.16	1.11%	13.47%
联京光电	材料采购	38.79	0.01%	0.03%	8.24	0.00%	0.01%	13.87	0.01%	0.01%
合计		5,903.10	1.18%	-	4,804.76	1.20%	-	8,101.42	5.38%	-

注：上表中的占比指占当期营业成本的比例。

上述主要关联采购的交易内容、采购的主要内容、定价依据如下：

关联方	交易内容	采购的主要内容	定价依据及公允性
联华电子及新加坡分公司	采购材料	硅片及化学品等原材料	硅片、化学品等原材料价格按照联华电子外采移动平均单价确定。
		晶圆	晶圆价格由双方以市场价为基础协商确定，定价合理，价格公允。
	接受劳务	12英寸晶圆厂建造、营运支援服务等	服务价格=联华电子实际发生的总成本*(1+5%)，实际发生的总成本包括人事费用、保险费、行政费用、训练费用、差旅费等，5%为中国台湾地区的营业税。定价具有商业合理性，价格公允。
		营销支持服务	营销支持服务价格=实际发生总成本*(1+7.5%)*(1+5%)，其中5%为中国台湾地区的营业税率。实际发生总成本为相关人事费用如薪资、奖金、加班费，公积金等，定价依据具有商业合理性，价格公允。
联京光电	材料采购	LED灯	采购价格由双方以市场价格为基础协商确定，并且采购的金额较小，定价合理，价格公允。

②向其他关联方采购货物或服务

单位：万元

关联方	交易内容	2018年			2017年			2016年		
		金额	占比	同类交易占比	金额	占比	同类交易占比	金额	占比	同类交易占比
美日光罩	材料采购	9,238.61	1.85%	6.40%	5,684.38	1.43%	4.63%	2,575.02	1.71%	2.56%
智原	IP	759.60	0.15%	20.18%	831.31	0.21%	0.59%	349.00	0.23%	0.34%
	接受劳务	-	-	-	13.21	0.00%	0.06%	-	-	-
盟智科技	材料采购	166.24	0.03%	0.12%	500.18	0.13%	0.41%	207.34	0.14%	0.21%
欣兴电子	材料采购	46.94	0.01%	0.03%	106.69	0.03%	0.09%	55.44	0.04%	0.06%
合计		10,211.39	2.04%	-	7,135.77	1.80%	-	3,186.80	2.12%	-

注：1、上表中的占比指占当期营业成本的比例；2、智原包括智原科技及其子公司智原科技（上海）有限公司、智原微电子（苏州）有限公司和寅通科技股份有限公司；3、美日光罩包括美日光罩及其子公司厦门美日丰创光罩有限公司。

上述主要关联采购的交易内容、采购的主要内容、定价依据如下：

关联方	交易内容	采购的主要内容	定价依据及公允性
美日光罩	材料采购	光罩	发行人从美日光罩采购的价格是由双方协商确定，是市场化的行为，定价具有商业合理性，价格总体公允。
智原科技	特许权使用	IP 授权	发行人支付给智原科技的技术使用费参考国际市场技术使用协议安排，经协议双方协商确定，技术使用费率同发行人与非关联方技术使用费率相似。技术授权使用费率总体合理，定价总体公允。
盟智科技	材料采购	化学品	以市场价为基础协商确定，定价合理，价格公允。
欣兴电子	材料采购	封装测试材料	以市场价为基础协商确定，定价合理，价格公允。

（2）向关联方销售货物或提供服务

① 向联华电子及其控制的其他公司销售货物或服务

单位：万元

关联方	交易内容	2018 年度			2017 年度			2016 年度		
		金额	占比	占同类交易的比例	金额	占比	占同类交易的比例	金额	占比	占同类交易的比例
美国联电	销售商品	20,598.30	5.58%	5.82%	9,833.24	2.93%	3.06%	8,675.40	4.62%	4.73%
	提供劳务	260.73	0.07%	5.19%	0.32	0.00%	0.00%	-	-	-
	销售光罩	1,488.56	0.40%	16.45%	635.59	0.19%	13.52%	-	-	-
	其他	15.01	0.00%	2.57%	23.24	0.01%	6.22%	93.81	0.05%	54.78%
日本联电	销售商品	5,734.51	1.55%	1.62%	4,556.96	1.36%	1.42%	3,285.12	1.75%	1.79%
	销售光罩	174.43	0.05%	1.93%	295.65	0.09%	6.29%	33.37	0.02%	11.62%
	其他	22.92	0.01%	3.92%	118.73	0.04%	31.79%	-	-	-
联华电子及其新加坡分公司	销售材料	734.17	0.20%	69.54%	1,396.40	0.42%	93.91%	237.24	0.13%	65.05%
	提供劳务	460.24	0.12%	9.17%	840.85	0.25%	10.34%	958.13	0.51%	28.48%
	销售商品	170.86	0.05%	0.05%	175.03	0.05%	0.05%	36.95	0.02%	0.02%
	销售光罩	23.27	0.01%	0.26%	66.09	0.02%	1.41%	-	-	-
	其他	62.58	0.02%	10.70%	5.38	0.00%	1.44%	-	-	-
合计		29,745.58	8.06%	-	17,947.48	5.36%	-	13,320.02	7.10%	-

注：上表中的“占比”指占当期营业收入的比例。

上述主要关联销售的交易内容、销售的主要内容、定价依据如下：

关联方	交易内容	销售的主要内容	定价的依据及公允性
美国联电	销售商品	晶圆	发行人销售给美国联电的价格在美国联电对外销售的价格的基础上给与一定的折扣，折扣金额即为代理费。发行人给予美国联电折扣比例约为 1%。定价具有商业合理性，价格公允。
	销售光罩	光罩	销售价格是按照发行人采购光罩成本价为基础确定，定价合理，价格公允。
	提供劳务	封装加工服务	服务价格是按照封装测试服务的市场价确定，定价合理，价格公允。
日本联电	销售商品	晶圆	发行人销售给日本联电的价格在日本联电对外销售的价格的基础上给与一定的折扣，折扣金额即为代理费。发行人给予日本联电折扣比例约为 2%-5%。定价具有商业合理性，价格公允。
	销售光罩	光罩	销售价格是按照发行人采购光罩的成本价为基础确定，定价合理，价格公允。
联华电子及其新加坡分公司	销售材料	硅片、光阻等原材料	销售价格按照发行人硅片、光阻等原材料移动平均采购单价确定，定价合理，价格公允。
	提供劳务	营销支持服务	收取的服务费=实际发生总成本*(1+7.5%)*(1+6%)，其中6%为中国大陆增值税税率。实际发生总成本为相关人事费用如薪资、奖金、加班费、公积金等，定价具有商业合理性，价格公允。
		集成电路设计服务	服务价格是依据设计服务的市场价格确定，定价合理，价格公允。
	销售商品	晶圆	厦门联芯的晶圆销售价格为联华电子销售给最终客户价格的98%，定价具有商业合理性，价格公允；和舰芯片晶圆销售价格以成本价为基础确定，交易金额小，价格总体公允。
	销售光罩	光罩	销售价格按照发行人购买光罩成本价为基础确定，定价合理，价格公允。
美国联电、日本联电、联华电子及其新加坡分公司	其他	加急生产服务	按照加急程度，每批次收取 0.5-1 万美元的加急费用，定价合理，价格公允。
		报废晶圆	按照生产出的合格晶圆的价格收取费用，定价合理，价格公允。

②向其他关联方销售货物或服务

单位：万元

关联方	交易内容	2018 年度			2017 年度			2016 年度		
		金额	占比	占同类交易的比例	金额	占比	占同类交易的比例	金额	占比	占同类交易的比例
联咏科技	销售商品	46,886.44	12.69%	13.26%	59,513.84	17.71%	18.52%	52,116.40	27.76%	28.39%
	提供劳务	221.18	0.06%	4.40%	152.88	0.05%	1.88%	419.77	0.22%	12.48%
	其他	-	-	-	1.47	0.00%	0.39%	9.18	0.00%	5.36%
智原	销售商品	7,376.03	2.00%	2.09%	4,697.65	1.40%	1.46%	3,828.74	2.04%	2.09%
	销售光罩	1,315.19	0.36%	14.53%	971.62	0.29%	20.66%	56.70	0.03%	19.74%
	提供劳务	190.91	0.05%	3.80%	216.21	0.06%	2.66%	70.43	0.04%	2.09%
	其他	16.78	0.00%	2.87%	-	-	-	-	-	-
原相科技	销售商品	5,842.49	1.58%	1.65%	5,385.56	1.60%	1.68%	6,527.28	3.48%	3.56%
	其他	-	-	-	-	-	-	2.36	0.00%	1.38%
联阳半导体	销售商品	4,328.00	1.17%	1.22%	3,583.02	1.07%	1.12%	3,845.79	2.05%	2.09%
	提供劳务	84.67	0.02%	1.69%	15.68	0.00%	0.19%	-	-	-
	其他	2.83	0.00%	0.48%	-	-	-	-	-	-
盛群半导体	销售商品	4,992.26	1.35%	1.41%	3,124.25	0.93%	0.97%	995.20	0.53%	0.54%
	其他	1.30	0.00%	0.22%	18.92	0.01%	5.07%	1.56	0.00%	0.91%
福建晋华	提供劳务	141.95	0.04%	2.83%	1,356.17	0.40%	16.68%	-	-	-
矽统科技	提供劳务	28.81	0.01%	0.57%	20.48	0.01%	0.25%	26.83	0.01%	0.80%
合计		71,428.84	19.33%	-	79,057.75	23.53%	-	67,900.24	36.16%	-

注：1、上表中的“占比”指占当期营业收入的比例；2、智原包括智原科技及其子公司智原科技（上海）有限公司、智原微电子（苏州）有限公司和寅通科技股份有限公司

上述主要关联销售的内容、定价依据及合理性、交易价格的公允性分析如下：

关联方	交易内容	销售的主要内容	定价的依据及公允性
联咏科技	销售商品	晶圆、光罩	联咏科技作为知名的芯片设计公司对芯片的需求量很大，为避免产能闲置，发行人给予联咏科技一定的价格优惠以吸引其增加下单数量，从而导致发行人对联咏科技销售的毛利率低于其他客户。发行人和联咏科技之间交易是市场化行为，发行人对其销售定价总体公允，具有商业合理性。
联阳半导体、盛群半导体、智原、原相科技	销售商品	晶圆和晶粒、光罩	发行人和联阳半导体、盛群半导体、智原、原相科技交易是市场化行为，定价具有商业合理性，价格公允。
		加急生产服务	按照加急程度，每批次收取 0.5-1 万美元的加急费用，交易的金额较小，定价合理，价格公允。
	其他	报废晶圆	按照生产出的合格晶圆的价格收取费用，交易的金额较小，定价合理，价格公允。

联咏科技、 联阳半导体、智原科技、矽统科技	提供劳务	集成电路设计服务	价格是依据集成电路设计逻辑门的个数、工艺节点、服务的内容、复杂性，通过双方的协商确定，定价公允。
福建晋华	提供劳务	培训服务	厦门联芯收取的费用包括训练费、场地与设备使用费等，服务价格是双方通过协商确定，定价合理，价格公允。

2、偶发性关联交易

(1) 采购设备

单位：万元

关联方	2018 年度	2017 年度	2016 年度
联华电子及其新加坡分公司	5,985.79	843.26	6,299.99
永盛山东	694.27	364.73	471.81
合计	6,680.06	1,207.98	6,771.80

报告期内，股份公司向联华电子及其新加坡分公司采购的设备主要是蚀刻机、量测仪、检验机等。交易价格以设备账面价值为基础，双方基于市场价格协商确定，定价公允。

股份公司从永盛山东采购的是分布式光伏产品和服务，主要用于光伏发电。2016 年、2017 年发行人与永盛山东之间的交易是按照成本加上一定的利润率确定价格，其中设备部分的利润率为 2%，施工部分的利润率为 5%-10%；由于光伏设备及服务价格的波动性，2018 年厦门联芯与永盛山东的交易是在和舰采购价格的基础上参考市场价确定价格，交易具有商业合理性，定价公允。

(2) 出售设备

发行人于 2017 年向联华电子出售冷却机、控制器、真空帮浦等二手设备，金额为 13.61 万元，交易价格以设备账面价值为基础，双方协商确定，金额较小，定价公允。

(3) 技术授权

① 联华电子授权和舰芯片使用 0.13 μm 制程

2013 年 7 月，发行人与联华电子签订技术授权合同，发行人取得联华电子关于制造内含最小特征尺寸为 0.13 μm 制程晶圆代工技术，合约有效期间为 2013 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 10 日。发行人于合同签订后 3 个月内向联华电子公司支付 500 万美元作为取得该技术授权对价。2018 年 7 月，发行人与联华电子续签前述技术授权合同，合约有效期间为 2018 年 7 月 11 日至 2028 年 7 月 10 日，确定发行人已于原技术授权合同签署后支付 500 万美元予联华电子，发行人在本次技术授权合同签署后无须再行支付权利金。

② 联华电子授权厦门联芯使用 28nm 及 40/55nm 制程

厦门联芯于 2015 年 12 月和 2017 年 4 月分别与联华电子签订《12 吋晶圆技术授权契约书》，联华电子向厦门联芯提供有关 28nm 及 40/55nm 制程晶圆代工技术，其中 28nm 技术授权期间为 2017 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，40/55nm 的技术授权期间为 2015 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，授权费分别为 2 亿美元和 1.5 亿美元。根据协议约定，上述技术授权费用已全部支付完毕。

③ 联华电子授权厦门联芯 80/90nm 制程

2018 年 11 月 23 日，厦门联芯与联华电子签订《技术授权契约书》，联华电子向厦门联芯提供 80/90nm 有关制程晶圆代工技术，合约的有效期自签署日起至届满 10 年之日止，共计 10 年。厦门联芯依授权产品之销售收入净额的 3% 计算应给付联华电子之权利金，并按季结算权利金，于每季结算后次月底前给付联华电子。2018 年度，厦门联芯应向联华电支付的技术权利金为 21.33 万元。

上述四个制程已分别取得台湾经济部投资审议委员审批，四个制程的定价分别是按照发行人或者厦门联芯产能占联华电子相应产能的比例，分摊制程的开发总成本加上一定的利润，同时考虑制程权利金占使用该制程所创造之收入比例确定。

由于晶圆代工行业制程技术授权一般不公布权利金的金额，而且发行人也未

从非关联第三方取得制程授权。发行人获得制程授权的权利金按照发行人或者厦门联芯产能占联华电子相应产能的比例分摊开发总成本加上一定的利润，同时考虑制程权利金占使用该制程所创造之收入比例确定，具有商业合理性，定价公允。

（4）转让厦门联芯股权

①2016年10月25日，和舰有限公司作出董事会决议，同意和舰有限公司将其持有厦门联芯21.7391%的股权（认缴注册资本276,039万元、实缴出资0元，缴付期限2017年1月31日）以零元价格转让给联华微芯。

2016年12月12日，厦门联芯作出股东会决议，同意股东和舰有限公司将其持有厦门联芯21.7391%的股权（认缴注册资本276,039万元、实缴出资0元，缴付期限2017年1月31日）转让给联华微芯，厦门联芯的其他股东厦门金圆、福建电子创业投资放弃对前述股权转让的优先受让权；厦门联芯的企业类型由有限责任公司（外商投资企业与内资合资）变更为有限责任公司（中外合资）。同日，和舰有限公司和联华微芯就前述股权转让事宜签署《股权转让协议》。

②2017年12月12日，和舰有限公司和厦门联芯分别作出董事会决议，同意和舰有限公司将其持有厦门联芯的28.9855%的股权（认缴出资368,052万元，实际资本0元，缴纳期限2018年1月缴纳245,368万元，2019年1月缴纳122,684万元）以零元价格转让给联华微芯。同日，和舰有限公司和联华微芯就前述股权转让签署了《股权转让协议》。

经本所律师审查，和舰有限公司上述转让厦门联芯的行为符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

（5）接受担保

2016年9月8日，厦门联芯与国家开发银行股份有限公司等七家银行签订银行贷款合同，贷款金额为13亿元及8亿美元，借款期限为2016年10月20日至2024年10月19日。2017年8月15日，厦门联芯与联华电子签署《背书保证约定书》，约定联华电子以联华微芯对厦门联芯的出资比例向贷款银行提供担

保，以不超过 3.1 亿美元为限。保证期间为主合同项下每笔债务履行届满之日起两年，保证费率为 0.3%/年，每年计收一次。2018 年 3 月 29 日，厦门联芯与联华电子重新签署了《背书保证约定书》，鉴于联华电子对厦门联芯的实际出资发生了变化，双方同意将保证金额上限由 3.1 亿美元调整到 4.62 亿美元，将保证费支付方式由每年计收一次改为每季度计收一次。2018 年 10 月 30 日，由于联华电子对厦门联芯的实际出资比例发生了变化，双方重新签署了《背书保证约定书》，将保证金额由 4.62 亿美元调整到 5.03 亿美元，每季度收取一次，其他条款未发生变化。

2018 年 8 月 23 日，联华电子与厦门联芯签署《关于对〈背书保证约定书〉保证费的确认》，确认每一计收期间保证费=厦门联芯向国开行等 7 家银行实际借款金额*联电微芯对厦门联芯实缴出资比例*年费率 0.3%*计收期间天数/360，前述保证费的计算方式自联华电子向厦门联芯提供保证开始适用。

厦门联芯于 2017 年、2018 年度分别向联华电子支付的担保费为 242.20 万元、928.17 万元。

联华电子收取厦门联芯上述担保费率按照非关联第三方向联华电子提供担保收取的担保费率确定，定价合理，价格公允。

(6) 资金拆借

① 厦门联芯向联华电子的借款

2017 年 2 月 13 日，厦门联芯与联华电子签订借款合同，约定自 2017 年 2 月 13 日至 2018 年 2 月 12 日止，厦门联芯可向联华电子借款 1.32 亿美元，借款年利率采用浮动利率（1 个月 LIBOR+50bps），每月重新计算利率，并依各月实际借款本金计算利息。厦门联芯实际自 2017 年 4 月 5 日至 2017 年 11 月 28 日累计向联华电子借款 1.32 亿美元，具体情况如下：

借款人	关联方	拆入金额(美元)	起始日	到期日
厦门联芯	联华电子	60,000,000.00	2017.4.5	2018.2.12
厦门联芯	联华电子	46,000,000.00	2017.10.11	2018.2.12

借款人	关联方	拆入金额(美元)	起始日	到期日
厦门联芯	联华电子	60,000,000.00	2017.4.5	2018.2.12
厦门联芯	联华电子	46,000,000.00	2017.10.11	2018.2.12
厦门联芯	联华电子	26,000,000.00	2017.11.28	2018.2.12
合计	-	132,000,000.00	-	-

2017年、2018年借款产生利息费用为647.19万元和176.71万元，厦门联芯已按期偿还借款本金及利息。

②厦门联芯向联华电子新加坡分公司的借款

2018年1月19日，厦门联芯与联华电子新加坡分公司签订借款合同，约定厦门联芯自2018年1月19日至2019年1月18日止向联华电子新加坡分公司可借款金额2亿美元，借款年利率采用浮动利率（1个月LIBOR+50bps），每月重新计算利率，并依各月实际借款本金计算利息。厦门联芯于2018年2月5日向联华电子新加坡分公司借款1.6亿美元，厦门联芯于2018年9月26日提前归还了前述借款本金及利息。2018年，前述借款产生的利息费用为1,705.60万元

厦门联芯支付给联华电子及其新加坡分公司的借款利率为中国台湾、新加坡的同业拆借利率上浮0.5%，是市场化的借款利率，利率水平总体公允，符合发行人的利益。

(7) 代垫工资

2016年、2017年、2018年度，联华电子代厦门联芯垫付工资金额为785.07万元、988.83万元和384.30万元。具体原因如下：

厦门联芯于2016年10月与世源科技工程有限公司签订技术咨询顾问服务协议，由厦门联芯公司为福建晋华的存储器生产线建设项目提供建厂工程顾问咨询服务，参与该项目部分员工原在联华电子任职并在中国台湾缴纳社保。为帮助该部分员工在中国台湾缴纳社保，联华电子为厦门联芯垫付该部分项目人员部分薪资（以用来缴纳社保）、全部劳健保、退休金及往返中国台湾的差旅费，厦门联芯根据联华电子各月代付的费用加计5%中国台湾地区营业税进行结算。截至

2018年6月30日，厦门联芯已向联华电子支付了全部上述代垫工资等款项。自2018年6月30日起，联华电子不再代垫这部分员工的薪资、全部劳健保、退休金及往返中国台湾差旅费等。

(8) 关联租赁

出租房	承租方	租赁时间	租赁房屋地址	租金情况	2018年交易金额
厦门联芯	永盛山东	2017-9-14至 2019-2-13	厦门市翔安区万家春路899号DR宿舍区	每间房每月租金1,243元，住宿房间数和日期以实际入住情况为准。	7.55万元
	福建晋华	2018-3-19至 2018-5-18		每间房每月租金1,900元，住宿房间数和日期以实际入住情况为准。	5.18万元

永盛山东和福建晋华是以市场价租赁该处房产，交易金额较小，定价合理，价格公允。

另外，根据股份公司提供的资料及本所律师审查，2018年12月25日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过厦门联芯公司拟向联华电子采购21台二手晶圆生产相关设备，交易价格以评估价值为基准，交易金额12,933.12万元，关联董事予以了回避表决。2019年1月10日，发行人召开2019年第一次临时股东大会，审议通过上述交易事项，关联股东予以了回避表决。就上述交易，中和资产评估有限公司已出具编号为中和评报子(2018)第BJV2075号的《联芯集成电路制造(厦门)有限公司拟向联华电子股份有限公司购买二手设备项目资产评估报告书》。

(三) 股份公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易内部决策制度等股份公司内部规章制度中明确了关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

股份公司直接控股股东橡木联合、间接控股股东晶信科技、菁英国际、联华电子均出具《承诺函》，“承诺人现有及将来与发行人发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。承诺人保证将继续规范并逐步减少与发行人及其控制的公司发生关联交易；保证承诺人及承诺人所控制的公司、分公司、合营

或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预发行人的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；保证将按照法律法规和发行人章程的规定，在审议涉及与承诺人的关联交易时，切实遵守在发行人董事会及股东大会进行关联交易表决时的回避程序。”

本所律师认为，股份公司已采取必要措施对其他股东利益进行了保护。

（四）同业竞争

根据股份公司提供的资料及本所律师核查，股份公司及下属子公司主要从事 12 英寸及 8 英寸专业晶圆代工、IC 设计服务业务，其中：股份公司主要从事 8 英寸专业晶圆代工，厦门联芯主要从事 12 英寸专业晶圆代工，山东联暉主要从事 IC 设计服务业务。

1、股份公司直接、间接控股股东橡木联合、晶信科技、菁英国际与股份公司之间不存在同业竞争

根据股份公司提供的资料并经本所律师核查，股份公司直接、间接控股股东橡木联合、晶信科技、菁英国际的主营业务均为投资，且橡木联合、晶信科技、菁英国际目前除持有股份公司及其下属子公司股权外，不存在其他对外投资。橡木联合、晶信科技、菁英国际与股份公司的主营业务不存在相同或相似的情形，橡木联合、晶信科技、菁英国际与股份公司间不存在同业竞争。

2、股份公司最终控股股东联华电子及其控制的其他企业不存在对股份公司构成重大不利影响的同业竞争

（1）根据联华电子近三年来公开披露的年度报告及其他信息披露文件、股份公司提供的资料、（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》等资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，股份公司最终控股股东联华电子及其控制的其他子公司中，与股份公司业务存在相同或类似业务的公司情况如下：

序号	公司名称	注册地/生产经营地	持股比例	主营业务
1	联华电子	中国台湾新竹	-	晶圆代工
2	联华电子新加坡分公司	新加坡	属于联华电子的分公司	晶圆代工
3	联颖光电	中国台湾新竹	联华电子、宏诚合计持股 78.47%	晶圆代工
4	美国联电	美国加利福尼亚	联华电子持股 100%	销售 IC
5	日本联电	日本东京	联华电子持股 100%	销售 IC
6	UNITED MICROELECTRONICS (EUROPE) B.V.	荷兰阿姆斯特丹	联华电子持股 100%	销售 IC
7	UMC KOREA CO., LTD.	韩国首尔	联华电子持股 100%	销售 IC
8	UMC TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD.	日本东京	联华电子子公司 OMNI 持股 100%	半导体制造技术开发及顾问咨询服务

此外，联华电子持股 15.87%的三重富士通的主营业务为晶圆制造，与股份公司业务相同或类似。2018 年 6 月 29 日，联华电子公告将收购三重富士通的股权，收购完成后，联华电子将持有其 100%的股权，三重富士通将成为联华电子的控全资子公司。2018 年 12 月 19 日，联华电子公告收购三重富士通的股权交易已于 2018 年 9 月 26 日通过中国台湾主管机关核准，目前还尚待其他相关主管机关的核准。若未能在 2019 年 10 月 1 日完成交易，将因购买权过期而丧失全数购买三重富士通的权利。

截至本法律意见书出具之日，除上述企业外，联华电子控制的其他公司与股份公司不存在相同或类似的业务，基本情况如下：

序号	公司名称	注册地/生产经营地	持股比例	主营业务
1	UMC CAPITAL CORP.	英属开曼群岛	联华电子持股 100%	投资
2	绿色星球	美属萨摩亚群岛	联华电子持股 100%	投资
3	弘鼎投资	中国台湾台北市	联华电子持股 100%	创业投资
4	UMC INVESTMENT (SAMOA)	美属萨摩亚群岛	联华电子持股 100%	投资

	LIMITED			
5	宏诚投资	中国台湾台北市	联华电子持股 100%	创业投资咨询规划
6	OMNI	美属萨摩亚群岛	联华电子持股 100%	投资
7	SINO PARAGON LIMITED	美属萨摩亚群岛	联华电子持股 100%	投资
8	联相光电	中国台湾台中市	联华电子、宏诚投资、弘鼎投资合计持股 93.36%	太阳能电池制造与买卖
9	UMC CAPITAL (USA)	美国加利福尼亚	联华电子子公司 UMC CAPITAL CORP. 持股 100%	投资
10	SOARING CAPITAL CORP.	美属萨摩亚群岛	联华电子子公司弘鼎投资持股 100%	投资
11	真宏企业管理顾问(上海)有限公司	中国上海	联华电子孙公司 SOARING CAPITAL CORP. 持股 100%	投资之引介及咨询
12	联华微芯	英属开曼群岛	联华电子子公司绿色星球持股 100%	投资
13	联旭能源	中国台湾新竹县	联华电子子公司宏诚投资持股 100%	能源技术服务
14	永盛香港	中国香港	联华电子孙公司联旭能源持股 100%	投资
15	永盛山东	中国山东	联华电子曾孙公司永盛香港持股 100%	太阳能机电整合设计服务
16	UNITED MICROTECHNOLOGY CORPORATION (NEW YORK)	美国纽约	联华电子子公司 OMNI 持股 100%	研究发展
17	UNITED MICROTECHNOLOGY CORPORATION (CALIFORNIA)	美国加利福尼亚	联华电子子公司 OMNI 持股 100%	研究发展
18	ECP VITA PTE. LTD.	新加坡	联华电子子公司 OMNI 持股 100%	保险
19	联颖光电投资	美属萨摩亚群岛	联华电子子公司联颖光电持股 100%	投资
20	WAVETEK MICROELECTRONICS CORPORATION (USA)	美国加利福尼亚	联华电子孙公司联颖光电投资持股 100%	销售及市场服务
21	SOCIALNEX ITALIA 1 S. R. L.	意大利米兰	联华电子子公司联相光电持股 100%	电厂

(2) 报告期内，联华电子及其控制的其他公司和股份公司已通过市场区域的划分避免同业竞争

针对联华电子及其控制的其他企业和股份公司存在从事相同或类似业务的

情况，股份公司与联华电子进行了市场区域划分并签署了《避免同业竞争协议》且联华电子签署了《关于避免同业竞争事项的承诺》。联华电子及其控制的其他企业市场区域为中国台湾、日本、韩国、北美洲、新加坡、欧洲市场，股份公司市场区域为大陆区域及联华电子市场区域之外所有其他区域，双方进入对方市场均需要支付代理费或服务费。

①中国芯片行业特征决定双方各自需要跨区域销售

晶圆代工厂的主要客户是芯片设计公司，中国大陆是全球最大的芯片消费市场，约占据全球芯片消费市场的 60%，但目前中国大陆芯片设计公司跟全球设计龙头企业相比，整体差距明显。根据 IC Insights 公布的 2018 年全球前 50 名芯片设计公司名单，美国占据芯片设计公司销售额的 69%、中国台湾占 16%，中国大陆占 12%排在第三位，且中国大陆芯片设计公司在先进制程方面跟国外差距较大。中国大陆设计公司现状难以满足股份公司先进制程产能需求，因此客观上股份公司需要向美国、中国台湾等芯片设计公司集中区域开发客户，以提高产能利用率。

股份公司主要从事 12 英寸及 8 英寸专业晶圆研发制造，涵盖 28nm、40nm、90nm、0.11 μm 、0.13 μm 、0.18 μm 、0.25 μm 、0.35 μm 、0.5 μm 等制程，而中国大陆地区客户对于各节点制程工艺的需求都较为广泛，股份公司的制程工艺、产能无法全部满足（如 14nm、65nm 等制程），而股份公司最终控股股东联华电子有相应的制程工艺、产能，以及部分客户指定等原因，为了满足客户需求，因而存在联华电子在大陆区域销售的情况。

④ 报告期内跨区域销售的情况

报告期内，发行人与联华电子及其控制的其他企业遵循了市场区域划分的原则，就各自进入对方市场区域事项，发行人与联华电子签署了《销售服务合约》，约定联华电子在台湾地区为发行人提供晶圆代工业务营销支持服务，发行人在大陆地区为联华电子提供晶圆代工业务营销支持服务。双方提供的服务包括：市场商情收集；协助客户的接洽联系；协助报价单及客户订单之传递；其他相关事项。

其中发行人向联华电子支付的服务费=联华电子所提供服务的总成本*(1+7.5%)*(1+5%)，实际发生的总成本包括人事费用、保险费、行政费用、训练费用、差旅费等，5%为台湾地区的营业税；联华电子向发行人支付的服务费=发行人所提供服务的总成本*(1+7.5%)*(1+6%)，其中6%为中国大陆增值税税率。实际发生总成本为相关人事费用如薪资、奖金、加班费、公积金等。

同时发行人通过联华电子控制子公司美国联电、日本联电销售产品，给予其一定折扣作为代理费，其中美国联电收取的代理费为其对外销售价格的1%，日本联电收取的代理费为其对外销售价格的2%-5%。

报告期内发行人与联华电子及其控制的其他企业分别在对方市场区域销售晶圆和支付服务费或者代理费的具体情况如下：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
发行人在联华电子市场区域销售晶圆金额	177,987.68	133,203.35	98,988.42
发行人支付的服务费或代理费	563.85	387.07	269.41
联华电子在发行人市场区域销售晶圆金额	103,304.73	142,644.43	176,171.35
联华电子支付的服务费	365.34	486.24	594.49

联华电子在发行人市场地区销售晶圆金额从2016年的176,171.35万元快速下降到2018年的103,304.73万元，降幅41.36%，而发行人在联华电子市场区域销售晶圆金额从2016年的98,988.42万元，增加到2018年的177,987.68万元，增幅高达79.81%，发行人在其市场区域晶圆销售金额从2016年的84,443.39万元，增加到175,702.94万元，增幅高达108.07%。从发行人在国内外市场的销售情况看，上述市场区域划分未对发行人产生不利的影响。

根据《避免同业竞争协议》划分的市场区域，在发行人的市场区域范围内，2018年联华电子及其控制的其他企业销售的8英寸与发行人相同制程的晶圆的收入为26,028.46万元，发行人的销售收入为119,853.27万元，联华电子及其控制的其他企业销售的8英寸与发行人相同制程的晶圆的收入占发行人的比例为21.72%，联华电子及其控制的其他企业销售的8英寸与发行人相同制程的晶圆的毛利为10,130.72万元，发行人对应的毛利为42,035.61万元，联华电子及其控制的其他企业销售的8英寸与发行人相同制程的晶圆的毛利占比为24.10%。2018年联华电子及其控制的其他企业8英寸与和舰相同制程在发行人市场区域

收入、毛利占比均低于 30%。

2018 年联华电子及其控制的其他企业 12 英寸相关制程在和舰芯片销售区域销售收入占比超过 30%，因为发行人子公司厦门联芯 2016 年 11 月才投产，目前正处于产能爬坡期，产品涵盖 28nm、40nm 和 90nm，且非流动资产折旧和摊销金额太大，导致相关产品毛利为负，因此 12 英寸收入和毛利不具有可比性。随着厦门联芯的 12 英寸产能逐渐提升，联华电子及其控制的其他企业 12 英寸相关制程在和舰芯片销售区域的销售收入占比逐年下降。

(2) 股份公司已经在中国大陆地区确立了稳固的市场地位且充足的市场空间有利于避免潜在的同业竞争

股份公司成立于 2001 年，在中国大陆生产经营十几年，积累了良好的声誉和较大的客户群。股份公司 2016 年、2017 年、2018 年度来自于中国大陆的主营业务收入为 65,209.89 万元、166,063.43 万元、154,876.86 万元，占股份公司主营业务收入的比例为 35.33%、51.32%、43.37%。根据中国半导体协会发布 2017 年统计数据显示，股份公司是中國半导体制造十大企业之一。股份公司已在中國大陸确定了稳固的市场地位。

近年来，集成电路在中国的快速发展使得股份公司具有充足的市场空间，根据《国家集成电路产业发展推进纲要》，到 2020 年我国集成电路全行业销售收入年增速超过 20%，根据中国半导体协会预计，2020 年我国集成电路产业销售规模预估达到 9,825.4 亿元，市场前景广阔。股份公司将利用现有的市场地位，努力抓住中国地区集成电路产业快速发展的历史机遇，积极拓展业务，凭借股份公司在技术、管理等方面的优势巩固并进一步提高在中国大陆区域的市场占有率，增加来自中国大陆区域销售收入的比例。股份公司大力研发 12 英寸先进及特色工艺制程，加快人工智能、5G 等前沿芯片技术上市速度，扩大 12 英寸及 8 英寸的产能，在制程和产能上满足大陆客户的需求，逐步减少与联华电子及其控制的企业发生的关联交易。

(3) 发行人将拓展的海外市场不同于联华电子的市场区域

随着发行人业务的发展，除中国大陆市场外，发行人未来可能会考虑将业务拓展至海外市场，依据发行人与联华电子签署的《避免同业竞争协议》及联华电子签署的《关于避免同业竞争事项的承诺》，联华电子的市场区域为中国台湾地区、日本、韩国、北美洲、新加坡、欧洲地区，上述市场区域之外的海外市场属于发行人市场区域，发行人将拓展的海外市场不同于联华电子的市场区域。

(4) 为明确双方权利义务关系，保护各自利益，使得双方更好的遵循市场划分的原则，发行人与橡木联合、晶信科技、菁英国际、联华电子已签署了《避免同业竞争协议》、《关于避免同业竞争事项的承诺》。根据《避免同业竞争协议》、《关于避免同业竞争事项的承诺》，各方确认并承诺如下：

①联华电子及其控制的企业（除发行人外）的市场区域为中国台湾地区、日本、韩国、北美洲、新加坡、欧洲市场。发行人的市场区域为大陆区域及联华电子市场区域之外所有其他区域。

②发行人与联华电子及其控制的企业（除发行人外）各自晶圆产品存在各自进入对方市场区域的情形，为保障各自利益，若发行人与联华电子及其控制的企业（除发行人外）进入对方所属市场区域，进入方需向对方缴纳代理费或服务费，具体收费标准如下：

A、发行人向北美洲或日本销售采取经销模式，分别由联华电子控制的企业作为经销商销售给最终客户，销售价格在联华电子控制的企业对外销售的价格的基础上给与一定的折扣。折扣的金额即为代理费；

B、发行人向中国台湾、韩国、新加坡、欧洲地区销售时，联华电子及其控制的企业（除发行人外）有权向发行人收取服务费，服务费标准由双方根据提供服务实际发生的总成本为基础另行约定；

C、联华电子及其控制的企业（除发行人外）向中国大陆及中国台湾、北美洲、日本、韩国、新加坡、欧洲以外的全球其他国家和地区销售时，发行人有权向其收取服务费，服务费标准由双方根据提供服务实际发生的总成本为基础另行约定。

③各自进入对方市场区域的条件

A、联华电子、发行人确认，发行人及其控股/控制企业对大陆客户、业务及联华电子市场区域外的全球其他国家或地区客户、业务具有主导权，只有下列情况下，联华电子或联华电子控股企业的晶圆产品才能进入发行人市场区域销售：

a、发行人及其控股/控制企业不能满足客户订单的技术水平时；或者

b、发行人及其控股/控制企业产能在时间和空间上不能满足客户订单要求；或者

c、发行人市场区域内客户指定联华电子及联华电子控股企业（除发行人外）生产的，以指定为准。

B、联华电子、发行人确认，联华电子及联华电子控股企业（除发行人外）在其业务区域具有优先承接业务的权利及主导权，但其市场区域晶圆产品订单遵循以下分配机制：联华电子及其控制的企业（除发行人外）市场区域内客户指定发行人或其控股/控制企业生产，在发行人或其控股/控制企业产能和技术能够满足客户要求的情况，由发行人或其控股/控制企业优先接单。

④联华电子进一步作出如下不可撤销的承诺和保证：联华电子本身及联华电子控股企业不会：

A、在联华电子市场区域外的全球其他国家或地区，新增单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与、经营、从事或协助从事或任何与发行人及其控股/控制企业主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动。

B、在联华电子市场区域外的全球其他国家或地区境内，以任何形式直接或间接支持发行人及其控股/控制企业以外的他人从事与发行人及发行人控股/控

制企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，且在联华电子市场区域外的全球其他国家或地区，以其它方式介入（无论直接或间接）任何与发行人及其控股/控制企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

若因两岸法律、政策因素或大陆政府因素导致联华电子支持或介入发行人及其控股/控制企业以外的他人从事与发行人及其控股/控制企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，联华电子、发行人确认，发行人及其控股/控制企业对该等业务具有主导权和同等条件下的优先收购权。

⑤发行人进一步作出如下不可撤销的承诺和保证：

A、发行人及其控股/控制企业在联华电子市场区域外的全球其他国家或地区不从事晶圆代工、IC设计服务业务（IC Design Support Service）以外的与联华电子及联华电子控股企业构成竞争的业务或活动。

B、发行人本身及控股/控制企业不会：

a、在联华电子市场区域单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与、经营或从事或协助从事或任何与联华电子及联华电子控股其他企业主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动。

b、在联华电子市场区域以任何形式直接或间接支持联华电子及联华电子控股企业以外的他人从事与联华电子及联华电子控股其他企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

c、在联华电子市场区域以其它方式介入（无论直接或间接）任何与联华电子及联华电子控股其他企业业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

d、发行人承诺其生产的晶圆产品不能由第三方转售至联华电子市场区域内。

⑥保障发行人具有优先发展、优先受让权

A、联华电子承诺，在本协议有效期内，在联华电子市场区域外的全球其他国家或地区，凡联华电子及联华电子控股企业有任何商业机会可从事、参与、入股、经营、协助、支持或介入任何可能与发行人及其控股/控制企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，联华电子及其控股/控制企业须将上述新商业机会以公平合理之条款让与发行人及其控股/控制企业。

B、联华电子及其控股企业承诺对于本协议有效期内，在中国台湾地区法律、政府主管机关允许及不受第三方限制的情况下，无论是由联华电子及/或联华电子控股企业自身研究开发或从第三方引进的或与他人合作开发的与发行人及其控股/控制企业主营业务有关的新产品或技术或利于发行人及其控股/控制企业主营业务在中国大陆及联华电子业务区域外的全球其他国家或地区具有优势竞争力的新产品或技术，联华电子及其控股企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其控股/控制企业优先生产或受让的权利。

C、若出现前述新商业机会、新产品或技术之业务，联华电子将积极促成发行人及其控股/控制企业能够从事该等新商业机会、新产品或技术之业务。且发行人应履行内部决策程序，发行人关联董事、关联股东予以回避表决，若发行人或其控股/控制企业因任何原因决定不从事上述新商业机会、新产品或技术之业务，应于决定后五日内以书面通知联华电子。

⑦发行人在中国大陆境外具有优先受让权

A、联华电子及联华电子控股企业承诺，在本协议有效期内，在中国大陆境外，因受国际环境影响或联华电子经营战略考虑，如有联华电子或联华电子控股企业拟向第三方转让或出售或以其它方式转让或允许使用全部或部分晶圆产品的资产、权益，发行人同等条件下具有优先受让权，联华电子及/或联华电子控股企业，须尽快将有关打算出售或转让的资产、权益的情况以书面形式通知发行人及其控股/控制企业（以下称“出让通知”），并立即提供发行人合理要求的资料。该出让通知应载明联华电子及联华电子控股企业拟转让或出售的第三方名称，拟向第三方转让或出售有关资产、权益的全部条件，该出让通知还应附有其它有助于对该资产、权益进行分析的数据或资料。

B、若出现前述同等条件下的优先受让之情形，联华电子将积极促成发行人及其控股/控制企业行使同等条件下的优先受让权，且发行人应履行内部决策程序，发行人关联董事、关联股东予以回避表决，若发行人或其控股企业因任何原因决定不行使上述同等条件下的优先受让权，应于决定后五日内以书面通知联华电子。

经本所律师审查，上述《避免同业竞争协议》已经双方股东大会审议通过，不存在违反中国台湾地区、中国大陆地区法律规定的情形，合法、有效，且各自进入对方市场区域收取费用，具有可执行性。本所律师认为，股份公司采取的上述避免同业竞争的措施合法、有效。

综上所述，本所律师认为，发行人与联华电子及其控制的其他企业已进行市场区域划分，且发行人市场区域内的客户由发行人主导并优先满足发行人产能状况，约定只有因为制程、产能以及客户指定等特殊原因才能进入对方销售区域，并收取代理费或服务费，从而避免了发行人与联华电子及其控制的其他企业之间的非公平竞争、利益输送、相互或者单方让渡商业机会的情形，不会对发行人未来发展产生不利影响。因此，发行人与联华电子及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

(五)股份公司已对有关关联交易及解决同业竞争的承诺与措施进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

十、股份公司拥有的主要资产

为查验股份公司的主要财产情况，本所律师核查了股份公司及其下属子公司提供的国有土地使用证、房屋所有权证、商标注册证、专利证书、《技术授权契约书》、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、股份公司出具的声明与承诺等资料，并对股份公司及其下属子公司保存的相关产权或权利证书原件进行核对；对股份公司及其下属子公司主要财产所在地进行实地查验；在此基础上，本所律师对股份公司及其下属子公司主要财产的权属及权利受限情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、

法规、规范性文件的规定予以验证。

(一) 股份公司及其下属全资、控股子公司目前拥有或使用的主要资产状况如下:

1、主要房产

序号	权属人	产权证号	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	取得方式	是否抵押
1	股份公司	苏(2018)苏州工业园区不动产权第0000181号	苏州工业园区方洲路333号	24,076.56	自建	否
2	股份公司	苏(2018)苏州工业园区不动产权第0000182号	苏州工业园区星华街333号	100,907.98	自建	否
3	股份公司	苏(2018)苏州工业园区不动产权第0000183号	苏州工业园区方洲路333号	49,647.85	自建	否
4	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072409号	翔安区万家春路899号F1主车间	186,441.4	自建	是
5	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072641号	翔安区万家春路899号生产设施用房	55,657.2	自建	是
6	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072596号	翔安区万家春路899号动力中心1	38,033.71	自建	是
7	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072461号	翔安区万家春路899号动力中心2	29,238.54	自建	是
8	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072634号	翔安区万家春路899号倒班宿舍及附属设施	17,671.9	自建	是
9	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072460号	翔安区万家春路899号变电站	3,018.5	自建	是
10	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072458号	翔安区万家春路899号废水站	11,777.09	自建	是

11	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072459号	翔安区万家春路899号实验室	2,054.08	自建	是
12	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072400号	翔安区万家春路899号仓储1	1,299.08	自建	是
13	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072618号	翔安区万家春路899号仓储2	181.48	自建	是
14	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072621号	翔安区万家春路899号仓储3	221.06	自建	是
15	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072626号	翔安区万家春路899号仓储4	14,569.02	自建	是
16	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072637号	翔安区万家春路899BC资源回收房	590.26	自建	是
17	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072631号	翔安区万家春路899号气体供应房1	678.48	自建	是
18	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072598号	翔安区万家春路899号气体供应房2	1,214.4	自建	是
19	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072611号	翔安区万家春路899号G1警卫室	1,214.13	自建	是
20	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072612号	翔安区万家春路899号G2警卫室	46.25	自建	是
21	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072644号	翔安区万家春路899号G3警卫室	28.09	自建	是
22	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072645号	翔安区万家春路899号G4警卫室	55.04	自建	是
23	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第0072647号	翔安区万家春路899号G5警卫室	28.09	自建	是
24	厦门联芯	闽(2018)厦门市不动产权第	翔安区万家春路899号风雨走廊	1,092.64	自建	是

		0072570 号				
25	厦门联芯	闽（2018）厦门市不动产权第0072454号	翔安区万家春路899号非机动车棚	946.08	自建	是
26	厦门联芯	闽（2018）厦门市不动产权第0072652号	翔安区万家春路899号燃气计量表站 EB1	10.65	自建	是
27	厦门联芯	闽（2018）厦门市不动产权第0072584号	翔安区万家春路899号燃气计量表站 EB2	10.37	自建	是
28	厦门联芯	闽（2018）厦门市不动产权第0072586号	翔安区万家春路899号燃气计量表站 EB3	9.25	自建	是
29	厦门联芯	闽（2018）厦门市不动产权第0072583号	翔安区万家春路899号燃气计量表站 EB4	9.42	自建	是
30	厦门联芯	闽（2018）厦门市不动产权第0072650号	翔安区万家春路899号燃气计量表站 EB5	10.6	自建	是
31	厦门联芯	闽（2018）厦门市不动产权第0072648号	翔安区万家春路899号燃气计量表站 EB6	11.02	自建	是
32	厦门联芯	闽（2018）厦门市不动产权第0072620号	翔安区万家春路899号燃气减压站	119.25	自建	是

本所律师认为，股份公司及其子公司厦门联芯拥有的上述房产真实、合法、有效。

2、国有土地使用权

序号	权利人	权证编号	位置	面积（m ² ）	用途	取得方式	是否抵押
1	股份公司	苏（2018）苏州工业园区不动产权第0000182号	苏州工业园区星华街333号	215,621.42	工业	出让	否
2	股份公司	苏（2018）苏州工业园区不动产权第0000183号	苏州工业园区方洲路333号	69,808.23	住宅	出让	否
3	股份公司	苏（2018）苏州工	苏州工业园区方	12,999.62	住宅	出让	否

		园区不动产权第 0000181号	洲路333号				
4	厦门联芯	厦国土房证第地 00020746号	翔安区厦门火炬 (翔安)产业区 X20147Y12-G 地 块	254,697.8	工业	出让	是

本所律师认为,股份公司及其子公司厦门联芯拥有的上述国有土地使用权真实、合法、有效。

3、主要注册商标

序号	注册人	商标注册号	名称及图形	核定使用商品类别	有效期限	取得方式	权利限制
中国大陆							
1	股份公司	第 4386174 号	和 舰	第 9 类	2017.07.21- 2027.07.20	原始取得	无
2	股份公司	第 4386175 号	和 舰	第 40 类	2018.06.14- 2028.06.13	原始取得	无
3	股份公司	第 4386176 号	和 舰	第 42 类	2018.06.14- 2028.06.13	原始取得	无
4	股份公司	第 4386177 号	HEJIAN	第 9 类	2017.08.14- 2027.08.13	原始取得	无
5	股份公司	第 4386178 号	HEJIAN	第 40 类	2018.05.28- 2028.05.27	原始取得	无
6	股份公司	第 4386179 号	HEJIAN	第 42 类	2018.05.28- 2028.05.27	原始取得	无
7	股份公司	第 4386180 号	Chip Shuttle	第 9 类	2018.01.7- 2028.01.6	原始取得	无
8	股份公司	第 4386181 号	Chip Shuttle	第 40 类	2018.06.28- 2028.06.27	原始取得	无
9	股份公司	第 4386187 号	Chip Shuttle	第 42 类	2018.07.07- 2028.07.06	原始取得	无
10	股份公司	第 4386188 号	HJTC	第 9 类	2017.06.07- 2027.06.06	原始取得	无
11	股份公司	第 4386189 号	HJTC	第 40 类	2018.07.07- 2028.07.06	原始取得	无
12	股份公司	第 4386172 号	HJTC	第 42 类	2018.06.14- 2028.06.13	原始取得	无

13	股份公司	第 5932536 号	HEJIAN YOUR FOUNDRY SOLUTION	第 42 类	2010.03.28- 2020.03.27	原始 取得	无
14	股份公司	第 5932537 号	和舰 集成电路领航者	第 42 类	2010.03.28- 2020.03.27	原始 取得	无
15	股份公司	第 5932538 号	HEJIAN YOUR FOUNDRY SOLUTION	第 40 类	2010.07.21- 2020.07.20	原始 取得	无
16	股份公司	第 5932539 号	和舰 集成电路领航者	第 40 类	2010.07.21- 2020.07.20	原始 取得	无
17	股份公司	第 5932540 号	HEJIAN YOUR FOUNDRY SOLUTION	第 9 类	2009.12.21- 2019.12.20	原始 取得	无
18	股份公司	第 5932541 号	和舰 集成电路领航者	第 9 类	2009.12.14- 2019.12.13	原始 取得	无
19	股份公司	第 6553292 号	HEFA	第 42 类	2010.12.07- 2020.12.06	原始 取得	无
20	股份公司	第 6553293 号	HEFA	第 40 类	2010.03.28- 2020.03.27	原始 取得	无
21	股份公司	第 6553294 号	HEFA	第 9 类	2010.04.14- 2020.04.13	原始 取得	无
22	股份公司	第 6553295 号	禾发	第 42 类	2010.09.28- 2020.09.27	原始 取得	无
23	股份公司	第 6553296 号	禾发	第 40 类	2010.03.28- 2020.03.27	原始 取得	无
24	股份公司	第 6553297 号	禾发	第 9 类	2010.04.14- 2020.04.13	原始 取得	无
25	厦门联芯	第 17819824 号	联芯集成电路	第 40 类	2016.10.14- 2026.10.13	原始 取得	无
26	厦门联芯	第 17819575 号	联芯集成电路	第 9 类	2016.12.21- 2026.12.20	原始 取得	无
27	厦门联芯	第 17819754 号	USCXM	第 40 类	2016.10.14- 2026.10.13	原始 取得	无
28	厦门联芯	第 17819512 号	USCXM	第 9 类	2016.10.14- 2026.10.13	原始 取得	无
29	厦门联芯	第 17819720 号	United Semi	第 40 类	2016.10.14- 2026.10.13	原始 取得	无

30	厦门联芯	第 17817791 号	United Semi	第 9 类	2016. 10. 14- 2026. 10. 13	原始 取得	无
31	厦门联芯	第 17819438 号	USC	第 9 类	2016. 12. 28- 2026. 12. 27	原始 取得	无
32	厦门联芯	第 17819731 号	USC	第 40 类	2016. 12. 21- 2026. 12. 20	原始 取得	无
中国台湾							
33	股份公司	01168655	HEJIAN	第 009 类	2025. 08. 15	原始 取得	无
34	股份公司	01167660	HEJIAN	第 040 类	2025. 07. 31	原始 取得	无
35	股份公司	01167774	HEJIAN	第 042 类	2025. 07. 31	原始 取得	无
36	股份公司	01168657	HJTC	第 009 类	2025. 08. 15	原始 取得	无
37	股份公司	01167662	HJTC	第 040 类	2025. 07. 31	原始 取得	无
38	股份公司	01167772	HJTC	第 042 类	2025. 07. 31	原始 取得	无
39	股份公司	01168658	Chip Shuttle	第 009 类	2025. 08. 15	原始 取得	无
40	股份公司	01182384	Chip Shuttle	第 040 类	2025. 11. 15	原始 取得	无
41	股份公司	01182486	Chip Shuttle	第 042 类	2025. 11. 15	原始 取得	无
42	股份公司	01168656	和艦	第 009 类	2025. 08. 15	原始 取得	无
43	股份公司	01167661	和艦	第 040 类	2025. 07. 31	原始 取得	无
44	股份公司	01167773	和艦	第 042 类	2025. 07. 31	原始 取得	无
中国香港							
45	股份公司	300855577	和舰	9、40、42	2027. 04. 19	原始 取得	无
46	股份公司	300855568	HEJIAN	9、40、42	2027. 04. 19	原始 取得	无
47	股份公司	300855559	HJTC	9、40、42	2027. 04. 19	原始 取得	无
日本							
48	股份公司	国际登录第 932101 号	和 舰	9、40、42	2027. 07. 11	原始 取得	无

49	股份公司	国际登录第 938020 号	HEJIAN	9、40、42	2027.07.06	原始 取得	无
50	股份公司	国际登录第 937777 号	HJTC	9、40、42	2027.07.06	原始 取得	无
韩国							
51	股份公司	国际登录第 932101 号	和 舰	9、40、42	2027.07.11	原始 取得	无
52	股份公司	国际登录第 938020 号	HEJIAN	9、40、42	2027.07.06	原始 取得	无
53	股份公司	国际登录第 937777 号	HJTC	9、40、42	2027.07.06	原始 取得	无

经本所律师审查，股份公司及其子公司厦门联芯拥有的上述注册商标真实、合法、有效。

4、主要专利

(1) 在中国大陆的专利

序号	专利权人	名称	类型	专利号	专利申请日	取得方式	权利限制
1	股份公司	解决非易失性存储器 SiO ₂ /SiN/SiO ₂ 叠层残留的制造方法	发明	ZL200710106099.3	2007.05.31	原始取得	无
2	股份公司	一种去除氧化物-氮化物-氧化物层的方法	发明	ZL200710182024.3	2007.10.17	原始取得	无
3	股份公司	一种 UV 光阻硬化机台异常的侦测方法	发明	ZL200810019674.0	2008.03.11	原始取得	无
4	股份公司	非易失性存储器及其制造方法	发明	ZL200810038357.3	2008.05.30	原始取得	无
5	股份公司	高压 MOS 器件栅氧化层可靠性的测试结构及方法	发明	ZL200810242831.4	2008.12.17	原始取得	无
6	股份公司	一种半导体制造生产的辅助分配系统及辅助分配方法	发明	ZL200810179259.1	2008.12.04	原始取得	无
7	股份公司	一种选择式射极太阳能电池的制造方法	发明	ZL200910142350.0	2009.06.01	原始取得	无
8	股份公司	一种降低接触孔蚀刻后簇状缺陷的方法	发明	ZL200910131045.1	2009.04.20	原始取得	无

9	股份公司	一种 PECVD 薄膜沉积的自动化制程控制方法	发明	ZL200910119149.0	2009.03.04	原始取得	无
10	股份公司	一种离子注入装置和方法	发明	ZL200910150033.3	2009.06.18	原始取得	无
11	股份公司	一种提升 CMOS 工艺中浅沟槽隔离性能的方法	发明	ZL201110270775.7	2011.09.14	原始取得	无
12	股份公司	沟槽型功率器件及其形成方法	发明	ZL201310526417.7	2013.10.30	原始取得	无
13	股份公司	图像传感器及其制造方法	发明	ZL200610119532.2	2006.12.13	原始取得	无
14	股份公司	一种应用于亚微米集成电路的肖特基二极管及其制造方法	发明	ZL200680055418.6	2006.08.18	原始取得	无
15	股份公司	一种用自对准氮化硅掩模形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL200680055457.6	2006.08.18	原始取得	无
16	股份公司	一种用于铜工艺无边导通孔的自对准氮化硅覆层方法	发明	ZL200680055512.1	2006.08.18	原始取得	无
17	股份公司	一种保护静电放电的硅控整流器	发明	ZL200710079578.0	2007.03.01	原始取得	无
18	股份公司	一种嵌壁式浅槽隔离结构及其形成方法	发明	ZL200710098209.6	2007.04.13	原始取得	无
19	股份公司	一种衬垫夹钳	发明	ZL200710025504.9	2007.08.01	原始取得	无
20	股份公司	一种沟槽型功率晶体管的沟槽结构的形成方法	发明	ZL200710108432.4	2007.06.07	原始取得	无
21	股份公司	一次可编程存储器的结构及其制造方法	发明	ZL200710106056.5	2007.05.31	原始取得	无
22	股份公司	改善高压产品 SRAM 功能和准备电压不合格问题的方法	发明	ZL200710143568.9	2007.08.09	原始取得	无
23	股份公司	一种从堆叠式栅极闪存中去除介质残余的方法	发明	ZL200710199092.0	2007.12.12	原始取得	无
24	股份公司	一种用于互连的气隙结构及其制造方法	发明	ZL200810099774.9	2008.06.11	原始取得	无
25	股份公司	一种超低 K 互连结构及其制造方法	发明	ZL200710301315.X	2007.12.26	原始取得	无
26	股份公司	栅极结构的制造方法	发明	ZL200810092786.9	2008.04.15	原始取得	无
27	股份公司	一种集成电路晶片结构及其制造方法	发明	ZL200810007232.4	2008.02.19	原始取得	无

28	股份公司	一种去除磷掺杂多晶硅表面氧化物的方法	发明	ZL200810134267.4	2008.07.23	原始取得	无
29	和舰有限公司	半导体元件及其制造方法	发明	ZL200810039106.7	2008.06.18	原始取得	无
30	和舰有限公司	具有气体缓冲均匀功能的离子源	发明	ZL200810155402.3	2008.09.28	原始取得	无
31	股份公司	内连线结构及其制造方法	发明	ZL200810042102.4	2008.08.27	原始取得	无
32	股份公司	一种栅氧化层的制造方法	发明	ZL200810135916.2	2008.07.03	原始取得	无
33	和舰有限公司	反应室的清洁方法	发明	ZL200810042802.3	2008.09.11	原始取得	无
34	股份公司	半导体制程	发明	ZL200810186310.1	2008.12.11	原始取得	无
35	股份公司	一种用于窄测试键的垂直探针卡	发明	ZL200810146225.2	2008.08.12	原始取得	无
36	股份公司	一种为 Lotus 数据库备份数据的方法	发明	ZL200910136530.8	2009.05.06	原始取得	无
37	股份公司	一种测试 NMOS 热载流子注入寿命的方法	发明	ZL200810171550.4	2008.10.17	原始取得	无
38	股份公司	一种晶圆片晶边清洗宽度的检测方法	发明	ZL200810157062.8	2008.09.23	原始取得	无
39	股份公司	一种形成改善的浅绝缘沟槽结构的方法	发明	ZL200810188161.2	2008.12.24	原始取得	无
40	股份公司	一种通过蚀刻形成半导体结构中的通孔的方法	发明	ZL200910005645.3	2009.02.02	原始取得	无
41	股份公司	一种通过改善浅沟槽绝缘结构的边缘形成晶片的方法	发明	ZL200910133903.6	2009.04.07	原始取得	无
42	股份公司	一种改善 MOSFET STI 差排的方法	发明	ZL200910133938.X	2009.04.10	原始取得	无
43	股份公司	具有浅槽隔离结构的半导体器件及其制造方法	发明	ZL200910261618.2	2009.12.18	原始取得	无
44	股份公司	一种检验晶片对准的方法	发明	ZL200910261621.4	2009.12.18	原始取得	无
45	股份公司	冷热板装置及其控温方法	发明	ZL201110385083.7	2011.11.28	原始取得	无
46	股份公司	离子植入机及离子植入的方法	发明	ZL201110137747.8	2011.05.26	原始取得	无
47	股份公司	一种减轻晶圆切割应力破坏的晶圆结构及版图设计	发明	ZL201110388108.9	2011.11.30	原始取得	无

		方法					
48	股份公司	机台调机时机械手臂存取晶片相对位置的监测装置及其监测方法	发明	ZL201110242744.0	2011.08.23	原始取得	无
49	股份公司	减小沟槽型功率晶体管沟槽内多晶硅顶端V型槽的方法	发明	ZL201110386845.5	2011.11.29	原始取得	无
50	股份公司	一种闪存单元及其制造方法	发明	ZL201210246930.6	2012.07.17	原始取得	无
51	股份公司	离子注入的监控方法	发明	ZL201310323779.6	2013.07.26	原始取得	无
52	股份公司	离子测量装置及其石墨层	发明	ZL201310490458.5	2013.10.18	原始取得	无
53	股份公司	离子注入设备及控制离子注入角度的方法	发明	ZL201310652816.8	2013.12.05	原始取得	无
54	股份公司	动力装置	发明	ZL201410004755.9	2014.01.06	原始取得	无
55	股份公司	一种具有绝缘防呆装置的PVD机台铝室的HTHU的加热器	发明	ZL201410471268.3	2014.09.16	原始取得	无
56	股份公司	一种用于金属溅镀机铝制程沉积腔的夹具环	发明	ZL201410474897.1	2014.09.17	原始取得	无
57	股份公司	用于旋涂机的压力检测系统、罐体及旋涂机	实用新型	ZL201320543082.5	2013.09.03	原始取得	无
58	股份公司	解离装置及具有该解离装置的钨金属化学气相沉积设备	实用新型	ZL201320548105.1	2013.09.03	原始取得	无
59	股份公司	一种晶圆清洗装置	实用新型	ZL201620168077.4	2016.03.04	原始取得	无
60	股份公司	一种具有自动吹气系统的机台	实用新型	ZL201621163801.0	2016.11.01	原始取得	无
61	股份公司	一种测漏装置	实用新型	ZL201721240448.6	2017.09.26	原始取得	无
62	和舰有限公司	一种快速热退火机台	实用新型	ZL200920269918.0	2009.10.30	原始取得	无
63	股份公司	一种用于喷涂光阻的机台	实用新型	ZL201020649310.3	2010.12.09	原始取得	无
64	股份公司	一种检测探针卡试打位置的测试键	实用新型	ZL201120569728.8	2011.12.30	原始取得	无
65	股份公司	一种背向点针显微镜系统	实用新型	ZL201220235363.X	2012.05.24	原始取得	无

66	股份公司	一种减少晶边研磨颗粒残留的装置	实用新型	ZL201520154335.9	2015.03.18	原始取得	无
67	股份公司	一种低温泵再生装置	实用新型	ZL201520933132.X	2015.11.20	原始取得	无
68	股份公司	一种 TC 固定装置	实用新型	ZL201620243968.1	2016.03.28	原始取得	无
69	股份公司	一种具有自检功能的自动给料系统	实用新型	ZL201620841540.7	2016.08.05	原始取得	无
70	和舰有限公司	分裂栅的制造方法	发明	ZL201310645870.X	2013.12.04	原始取得	无
71	和舰有限公司	一种嵌入块	实用新型	ZL201721505992.9	2017.11.13	原始取得	无
72	和舰有限公司	一种超纯净水罐更换工具	实用新型	ZL201721652940.4	2017.12.01	原始取得	无

(2) 在中国台湾的专利

序号	专利权人	名称	类型	专利号	专利权期间	取得方式	权利限制
1	股份公司	具有金属硅化物的半导体结构及形成金属硅化物的方法	发明	发明第 I352382 号	2011.11.11-2028.03.13	原始取得	无
2	股份公司	探测垫结构及其制造方法	发明	发明第 I355712 号	2012.01.01-2028.06.23	原始取得	无
3	股份公司	一种在炉管中沉积多晶硅的方法	发明	发明第 I421913 号	2014.01.01-2028.08.25	原始取得	无
4	股份公司	一种用于互连的气隙结构及其制造方法	发明	发明第 I470736 号	2015.01.21-2028.08.25	原始取得	无
5	股份公司	闸极结构的制造方法	发明	发明第 I363379 号	2012.05.01-2028.03.10	原始取得	无
6	股份公司	非挥发性记忆体及其制造方法	发明	发明第 I389303 号	2013.03.11-2028.05.01	原始取得	无
7	股份公司	半导体元件及其制造方法	发明	发明第 I372447 号	2012.09.11-2028.05.08	原始取得	无
8	股份公司	内连线结构及其制造方法	发明	发明第 I366247 号	2012.06.11-2028.07.22	原始取得	无
9	股份公司	一种闸氧化层的制造方法	发明	发明第 I414019 号	2013.11.01-2028.09.10	原始取得	无

10	股份公司	反应室的清洁方法	发明	发明第 I365494 号	2012.06.01-2028.06.29	原始取得	无
11	股份公司	半导体制程	发明	发明第 I377628 号	2012.11.21-2028.09.03	原始取得	无
12	股份公司	一种检测探针卡试打位置的测试键	实用新型	新型第 M461789 号	2013.09.11-2022.12.23	原始取得	无

(3) 在美国的专利

序号	专利权人	名称	类型	专利号	专利授予日	取得方式	权利受限
1	股份公司	IMAGE SENSOR	发明	US7,482,646B2	2009.01.27	原始取得	无
2	股份公司	FABRICATING METHOD OF IMAGE SENSOR	发明	US7,833,817B2	2010.11.16	原始取得	无
3	股份公司	SEMICONDUCTOR FABRICATING PROCESS	发明	US8,017,027B2	2011.09.13	原始取得	无

经本所律师审查，上述在中国大陆注册的部分专利权人载明为和舰有限公司，股份公司正在办理上述权属证书更名手续，经本所律师审查，股份公司办理上述权属证书的更名手续不存在法律障碍，股份公司拥有的上述专利真实、合法、有效。

5、集成电路布图设计

序号	权利人	布图设计名称	登记号	申请日	有效期	取得方式	权利受限
1	山东联曜	Wagtail	BS.165518790	2016.11.14	十年	原始取得	无
2	山东联曜	K6	BS.165518782	2016.11.14	十年	原始取得	无
3	山东联曜	HD2201	BS.165518774	2016.11.14	十年	原始取得	无
4	山东联曜	FSR0AS004A	BS.165518766	2016.11.14	十年	原始取得	无
5	山东联曜	CHX801	BS.165518723	2016.11.14	十年	原始取得	无
6	山东联曜	RL6436	BS.165519266	2016.11.21	十年	原始取得	无
7	山东联曜	ApolloC	BS.165519525	2016.11.30	十年	原始取得	无
8	山东联曜	Fighter	BS.175528411	2017.6.24	十年	原始取得	无
9	山东联曜	ILI7810	BS.175528438	2017.6.24	十年	原始取得	无
10	山东联曜	GR1000	BS.17552842X	2017.6.24	十年	原始取得	无

11	山东联璟	ANA37505	BS. 175528403	2017. 6. 24	十年	原始取得	无
12	山东联璟	P9920	BS. 175528446	2017. 6. 24	十年	原始取得	无

经本所律师核查,山东联璟拥有的上述集成电路布图设计真实、合法、有效。

6、被授权使用的非专利技术

(1)2013年7月11日,联华电子与和舰有限公司签署《技术授权契约书》,联华电子将其拥有的关于制造内含最小特征尺寸为0.13 μm 积体电路组件之半导体硅晶圆之制程技术、设计规则、电路布线、光罩图形档案、光罩等,以及前揭半导体制程技术之特殊应用与后续为改善前揭半导体制程技术之生产成本、产品良率及/或生产效率等所为之一切衍生性技术授权和舰有限公司在全世界使用,权利金为500万美元,授权期限为2013年7月11日至2018年7月10日。2018年7月11日,联华电子与和舰芯片签署《技术授权契约书》,联华电子将前述授权给和舰芯片使用的技术期限续展为2018年7月11日至2028年7月10日,并确认和舰芯片已于原技术授权契约书签署后支付给联华电子500万美元作为权利金,和舰芯片于本合约下无需再行支付权利金。

(2)2015年12月,联华电子与厦门联芯签署《12寸晶圆技术授权契约书》,联华电子将其拥有的关于制造内含最小特征尺寸为40/55纳米(40/55nm)集成电路组件之半导体硅晶圆之制程技术、设计规则、电路布线、光罩图形档案、光罩等技术,及后续为改善前揭半导体制程技术之生产成本、产品良率及/或生产效率等所为之一切衍生性技术授权厦门联芯在全世界使用,权利金为15,000万美元,授权期限为2015年12月1日至2019年12月31日

(3)2017年4月10日,联华电子与厦门联芯签署《12寸晶圆技术授权契约书》,联华电子将其拥有的关于制造内含最小特征尺寸为28纳米(28nm)集成电路组件之半导体硅晶圆之制程技术、设计规则、电路布线、光罩图形档案、光罩等技术,及后续为改善前揭半导体制程技术之生产成本、产品良率及/或生产效率等所为之一切衍生性技术授权厦门联芯在中国大陆(含港澳)使用,权利金为20,000万美元,授权期限为2017年4月1日至2022年3月31日。

(4)2018年11月23日,联华电子与厦门联芯签署《技术授权契约书》,

联华电子将其拥有的关于制造内含最小特征尺寸为 80/90 纳米(80/90nm) 集成电路组件之半导体硅晶圆之制程技术、设计规则、电路布线、光罩图形档案、光罩等技术，及后续为改善前揭半导体制程技术之生产成本、产品良率及/或生产效率等所为之一切衍生性技术授权厦门联芯在中大陆（含港澳）内生产、制造相关授权产品，并于全世界使用，厦门联芯应支付给联华电子的技术使用权利金为依授权产品之销货净额 3%，按季计算权利金，于每季结算后次月底前支付给联华电子，授权期限为合同签署日起十年。

就上述技术授权事项，联华电子已出具《承诺函》：承诺“一、本公司授权苏州和舰使用的技术为自有研发技术，本公司收取的 500 万美元为苏州和舰取得前述相关协议所定权利所应给付的全部对价，该等授权技术并无侵害他人专利权或其他智慧财产权情事，若苏州和舰使用该等授权技术引致第三方以苏州和舰侵害其专利权或其他智慧财产权为由起诉者，本公司应赔偿苏州和舰因此所支出的律师费、诉讼费用、损害赔偿金及苏州和舰因此所受的直接损害。二、本公司授权厦门联芯使用的技术为自有研发技术，本公司收取的 35,000 万美元为厦门联芯取得前述相关协议所定权利所应给付的全部对价，厦门联芯使用该等授权技术并无侵害他人专利权或其他智慧财产权情事，若厦门联芯使用该等授权技术引致第三方以苏州和舰侵害其专利权或其他智慧财产权为由起诉者，本公司应赔偿厦门联芯因此所支出的律师费、诉讼费用、损害赔偿金及厦门联芯因此所受的直接损害。三、本公司授权厦门联芯使用的技术为自有研发技术，本公司按照产品净额 3%收取的权利金为厦门联芯取得前述《技术授权契约书》(80/90nm 技术)所定权利所应给付的全部对价。厦门联芯使用本公司授权的前述授权技术并无侵害他人专利权或其他智慧财产权情事，若厦门联芯使用该等授权技术引致第三方以厦门联芯侵害其专利权或其他智慧财产权为由起诉者，本公司应赔偿厦门联芯因此所支出的律师费、诉讼费用、损害赔偿金及厦门联芯因此所受的直接损害。四、前述协议到期后，如经相关政府单位核准同意续展使用期限，本公司不会再要求苏州和舰或厦门联芯为前述技术使用再行向本公司支付权利金。”

经本所律师审查，股份公司及其下属子公司使用联华电子授权的上述非专利技术真实、合法、有效。

7、被授权使用的主要 IP 技术

截至本法律意见书出具之日，发行人及其子公司正在使用的被授权主要 IP 技术如下：

授权方	使用方	技术内容	应用领域	合同生效日	使用期限	定价依据
ARM LIMITED	和舰芯片	0.18 μ m SC/Memory/IO	晶圆制造	2004.9.1	主许可协议将在协议期限终止前自动延展连续的1年	根据实际出货及合约规定，计算权利金
		0.25 μ m SC/Memory/IO		2005.9.30		
		0.16 μ m SC/Memory/IO		2006.6.30		
美商矽成积体电路股份有限公司	和舰芯片	0.18 μ m standard & customized pFlash macro/0.153 μ m pFlash Customized macro/0.11/0.13 μ m pFlash Customized macro	晶圆制造	2015.8.1	2024.12.31	根据实际出货及合约规定，计算权利金
eMemory Technology Inc	和舰芯片	单一多晶 OTP	晶圆制造	2008.7.25	2021.12.31	根据实际出货及合约规定，计算权利金
		OTP		2011.10.1	-	
		OTP		2013.4.1	-	
		OTP		2014.9.1	-	
		OTP		2017.6.8	-	
		OTP		2018.6.15	-	
		NEOMTP		2016.9.7	2021.9.6	
NeoEE MTP	2017.12.5	2022.12.4				
智原科技	和舰芯片	0.25 μ m/0.18 μ m GII/0.18 μ m LL/ 0.15 μ m SP/0.13 μ m HS, LL SP/90nm SP process IP	晶圆制造	2004.8.5	2024.6.30	根据实际出货及合约规定，计算权利金
		0.11 μ m AE HS Process,		2011.12.30	2024.6.30	根据实际出货及合约规定，计算权利金
		0.11 μ m eFlash USB2.0:		2014.4.21	2024.6.30	
		0.11 μ m ULL pFlash		2016.12.30	2026.12.29	
0.18 μ m MMRF SC for Goodix	2017.9.28	2028.9.27				
GlobalCAD INC	和舰芯片	0.35 μ m generic logic process SC/IO/Memory	晶圆制造	2004.7.1	该协议将逐年在到期时自动续约一年	根据实际出货及合约规定，计算权利金
		0.50 μ m/0.35 μ m/0.25 μ m/0.18 μ m SC/IO/Memory		2012.5.15		
ARM LIMITE	厦门联芯	SC/Memory/IO	晶圆制造	2018.12.21	-	根据实际出货及合约规定，计算权利金
SYNOPSYS	厦门	40nm, 55nm SC/Memory/IO	晶圆	2016.6.1	2025.5.31	根据实际出货

INTERNATIONAL LIMITED	联芯	28nm SC/Memory/I/O	制造			及合约规定, 计算权利金
智原科技	厦门联芯	Generic Core/Memory/I/O	晶圆制造	2018. 10. 1	2028. 9. 30	根据实际出货及合约规定, 计算权利金

经本所律师审查, 股份公司及其下属子公司使用上述被授权主要 IP 技术真实、合法、有效。

8、域名

序号	注册人	域名	域名备案数据库	到期日	取得方式	权利受限制
1	股份公司	hjtc.com.cn	国内顶级	2020. 01. 16	原始取得	无
2	股份公司	和舰. 中国	国内顶级	2019. 12. 02	原始取得	无
3	股份公司	和舰科技. 中国	国内顶级	2019. 12. 02	原始取得	无
4	股份公司	和舰芯片. 中国	国内顶级	2019. 11. 30	原始取得	无
5	股份公司	和舰. 公司	国内顶级	2019. 08. 20	原始取得	无
6	股份公司	和舰科技. 公司	国内顶级	2020. 08. 20	原始取得	无
7	股份公司	uscxm.com	国际顶级	2020. 11. 28	原始取得	无
8	山东联暲	unitedds.com	国际顶级	2021. 03. 13	原始取得	无

经本所律师审查, 股份公司及其子公司山东联暲拥有的上述域名真实、合法、有效。

9、主要的资质证书

证书名称	资质等级	发证机关	权属人	证书号	有效期
高新技术企业证书	国家	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	发行人	GR201732001868	三年
ISO 14001:2015	国际认证	DNV. GL	和舰芯片	1578-2004-AE-RGC-RvA	2019. 9. 24
IATF16949:2016 (含产品设计)	国际认证	DQS	和舰有限公司	50050411IATF16	2021. 4. 11

ISO9001:2015	国际认证	DQS	和舰有限公司	50050411QM15	2021.4.11
IECQ QC 080000:2012	国际认证	Bsi	和舰有限公司	IECQ-H BSI 14.0005	2020.4.3
ISO /IEC 27001:2013 审核证书	国际认证	Bsi	和舰芯片	IS581023	2021.8.18
AEO高级认证企业证书	国家	中华人民共和国南京海关	和舰芯片	732513557002	-
排污许可证	市级	苏州工业园区国土环保局	和舰芯片	苏园环排证字 [20180271]号	2019.12.12
AEO高级认证企业证书	国家	中华人民共和国厦门海关	厦门联芯	302849667001	-
ISO 14001:2015	国际认证	SGS	厦门联芯	CN17/31382	2020.10.24
ISO 9001:2015	国际认证	DQS	厦门联芯	50600175 QM15	2021.4.24
ISO 45001: 2018	国际认证	SGS	厦门联芯	CN17/31767	2020.12.7
IECQ QC 080000:2017	国际认证	DQS	厦门联芯	IECQ-H ULTW 18.0004	2021-4-29
IATF16949:2016 (含产品设计)	国际认证	DQS	厦门联芯	50600175 IATF16	2021-4-24
排水许可证	市级	厦门市市政园林局	厦门联芯	厦排证字第 5032 号	2021.11.06
排污许可证	区级	厦门市翔安环境保护局	厦门联芯	350213-2018-000141	2019.12.28
高新技术企业证书	国家	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局	山东联曜	GR201737000763	三年

根据股份公司提供的资料，股份公司正在办理上述登记在和舰有限公司名下的资质证书的更名手续。经本所律师核查，股份公司办理上述资质证书的更名手续不存在法律障碍，股份公司拥有的上述资质证书真实、合法、有效。

10、主要生产经营设备情况

根据大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、发行人提供的固定资产盘点表及主要设备购置发票，并经本所律师核查，发行人目前主要生产经营设备包括曝光机、金属溅镀机、离子植入机、蚀刻机、光罩检验机等。上述主要生产经营设备均为发行人在从事生产经营活动期间购买而取得。发行人拥有上述主要生产经营设备真实、合法、有效。

11、长期股权投资

为查验股份公司的长期股权投资，本所律师核查了发行人控制、全资子公司及参股企业的营业执照、公司章程或合伙协议、股东名册等全套工商登记资料、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》；在此基础上，本所律师对发行人控制、控股子公司的设立、历次注册资本及股权变化是否符合法律、法规及规范性文件的规定予以验证。

根据股份公司提供的资料及本所律师审查，股份公司现时持有厦门联芯 14.49%的股权、山东联暎 100%的股权，厦门联和 9.705%的出资。

经本所律师审查，股份公司所持上述企业的股权不存在任何质押、被司法机关冻结等导致其行使股东权利受到限制的情形；且未有针对股份公司持有上述股权所产生的任何法律纠纷，亦不存在发生潜在纠纷的可能。股份公司持有上述股权真实、合法、有效。

(二) 股份公司及其下属子公司已实际拥有上述资产的所有权或使用权，因股份公司为和舰有限公司整体变更设立的股份有限公司，股份公司及其下属子公司拥有的土地、房产、注册商标、专利等资产权属证书正在办理或已部分办理完毕更名手续，股份公司及其下属子公司取得上述资产的完备的权属证书不存在法律障碍。

(三) 根据股份公司提供的有关材料以及本所律师调查，股份公司及其下属子公司拥有上述资产的所有权或使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(四) 根据大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》及股份公司提供的资料，截至 2018 年 12 月 31 日止，发行人设定抵押的机器设备账面价值为 5,767,282,316.89 元，房屋建筑物账面价值为 1,256,864,472.94 元，土地使用权账面价值为 69,509,270.00 元。除上述情形外，股份公司及其下属子公司对其拥有的其他主要财产的所有权或使用权的行使没有限制，亦不存在担保或其他权利受限制的情况。

(五) 承租房产情况

根据股份公司提供的资料，股份公司的子公司山东联暲、厦门联芯承租房产情况如下：

序号	出租人	承租人	坐落	面积 (m ²)	用途	租金	租赁期限
1	济南齐鲁软件园发展中心	山东联暲	济南高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼十七层1701房间	2,034.90	科研办公	0.9元/平方米·天	2019.2.1至2019.12.31
2	厦门科海联合房地产有限公司	厦门联芯	厦门市翔安区13-04片区滨海东大道与内垵大道交叉口西南侧2015XP01地块	17,320.69	宿舍	第一年租金标准为21元/m ² /月，之后每年度递增5%，但不应超过当年度该地段市场租赁评估价格的中间值，综合管理服务费标准：住宅2.7元/m ² /月，房屋专项维修资金收费标准住宅0.3元/m ² /月	2017.4.1至2024.3.31
3	厦门科海联合房地产有限公司	厦门联芯	厦门市湖里区枋湖二路东侧“2015P01地块”	5,281.21	宿舍	第一年租金标准为42元/m ² /月，之后每年度递增5%，但不应超过当年度该地段市场租赁评估价格的中间值，综合管理服务费标准：住宅2.95元/m ² /月，房屋专项维修资金收费标准住宅0.3元/m ² /月	2017.4.1至2024.3.31

2019年2月1日，济南齐鲁软件园发展中心有限公司与山东联暲签署合同编号为RJY2019-AS-17-008《房屋租赁合同》。2017年4月1日，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会（甲方）、厦门科海联合房地产有限公司（乙方）分别与厦门联芯（丙方）签署《火炬高新区人才用房及相应配套-翔美公寓人才房租赁协议》、《火炬高新区人才用房及相应配套-缘美公寓人才房租赁协议》。

济南齐鲁软件园发展中心持有济南市住房保障和房产管理局核发济房权证高字第068838号的《房屋所有权证》，规划用途为科研及科研配套用房，总层数30层，建筑面积为221,730.31平方米，土地使用权取得方式为出让。

厦门科海联合房地产有限公司就翔美公寓所在的土地使用权取得厦门市国土资源与房产管理局核发的厦国土房证第地00020772号《厦门市土地房屋权证》，土地坐落于翔安区13-04片区滨海东大道与内垵大道交叉口西南侧2015XP01地块，土地使用权类型为出让，土地用途为商业服务业、住宅；厦门科海联合房地产有限公司就翔美公寓的规划、建设于2015年5月26日、2016年3月11日分别取得厦门市规划委员会核发的建字第350213201504070号《建设工程规划许可证》和厦门市建设局核发的编号为350200201603110201《建筑工程施工许可证》。

厦门科海联合房地产有限公司就缘美公寓所在的土地使用权取得厦门市国土资源与房产管理局核发的厦国土房证第地00020773号《厦门市土地房屋权证》，土地坐落于湖里区枋湖北二路东侧2015P01地块，土地使用权类型为出让，土地用途为商业服务业、住宅；厦门科海联合房地产有限公司就缘美公寓建设及竣工验收分别于2016年3月11日取得厦门市建设局核发的编号为350200201603110101《建筑工程施工许可证》、于2018年4月27日取得厦门市建设局核发的编号为350200201804273484《建筑工程竣工验收备案证明书》。

根据出租方厦门科海联合房地产有限公司出具的《承诺函》，翔美公寓、缘美公寓系厦门科海联合房地产有限公司自建，合法所有，该等房屋用途为住宅，该等房屋的权属证书正在办理过程中；该公司有权将开发建设的翔美公寓、缘美公寓出租给厦门联芯作为员工宿舍使用，保证该等房屋不会因被第三方主张权利或存在权属纠纷而影响厦门联芯的正常使用。该公司承诺严格、完全履行该公司与厦门联芯签订的房屋租赁合同，厦门联芯能够依据房屋租赁合同维护其合法权益，若因房屋产权瑕疵造成厦门联芯履行房屋租赁合同产生损失，概由厦门科海联合房地产有限公司承担。

经本所律师审查，股份公司子公司厦门联芯租赁的、用于员工宿舍的房产存在出租方未取得房屋权属证书的情形，但上述出租人均与厦门联芯签订了租赁合同且出租方实际拥有上述房产，厦门联芯在租赁合同有效期内可持续使用上述房产，同时，厦门联芯租赁上述房产仅作为员工宿舍使用，即使上述房屋产权发生纠纷，厦门联芯可租赁到其他替代房产，厦门联芯租赁使用上述房产不会对其生产经营活动造成实质性影响。山东联曜租赁的科研办公场所其出租方实际拥有其

房产权属，山东联暎与出租方签订的租赁合同的内容合法、有效。

十一、股份公司的重大债权债务

为查验股份公司重大债权债务情况，本所律师核查了股份公司提供的正在履行的银行授信合同、借款合同及其担保合同、重大销售合同、重大采购合同、非专利技术使用合同、主要 IP 技术许可协议、租赁合同、相关财务凭证、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939 号《审计报告》、股份公司出具的声明与承诺等资料，对股份公司保存的相关合同或协议原件进行了核对，并对股份公司总经理、财务负责人进行了访谈；在此基础上，本所律师对股份公司的重大债权债务情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）本所律师在《律师工作报告》中披露了股份公司已履行完毕、正在履行的主要重大合同，本所律师通过对上述披露的主要重大合同的审查以及股份公司的说明，本所律师认为，股份公司上述披露的主要重大合同合法有效、履行正常，亦不存在潜在风险和纠纷。

（二）经本所律师审查，股份公司正在履行的上述重大合同中存在签订主体为和舰有限的情形，存在上述情形的重大合同已办理完毕合同签订主体的变更手续，或正在办理合同签订主体的变更手续。本所律师认为，上述重大合同的履行不存在法律障碍。

（三）根据本所律师调查以及股份公司保证，股份公司目前不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（四）股份公司与关联方间除因关联交易形成的债权债务外，不存在其他重大债权债务关系。根据股份公司提供的资料及本所律师审查，截至 2018 年 12 月 31 日，股份公司与关联方之间存在的担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联华电子	厦门联芯	联华电子公司以	2017. 8. 15	主合同项下	未履行完毕

		联华微芯对厦门联芯的出资比例		每笔债务履行届满之日起两年	
--	--	----------------	--	---------------	--

（五）根据股份公司的说明及大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》，截止2018年12月31日，股份公司其他应收款净额为40,371,298.59元，其他应付款余额为1,232,487,482.99元。股份公司金额较大的其他应收、应付款均因正常的生产经营活动发生，合法、有效。

十二、股份公司的重大资产变化及收购兼并

为查验股份公司近三年重大资产变化及收购兼并情况，本所律师核查了股份公司近三年的股本及其演变情况的工商档案资料、对外投资、关联交易及主要财产情况、股份公司相关内部决策文件、大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》以及股份公司出具的声明与承诺等资料；在此基础上，本所律师对股份公司的重大资产变化及收购兼并是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）股份公司近三年来发生的增资行为

关于股份公司近三年来发生的增资、减资行为见本《法律意见书》“七、股份公司的股本及其演变”之内容。

（二）和舰有限公司对厦门联芯增资、转让厦门联芯部分股权

1、对厦门联芯增资

2015年1月23日，和舰有限公司作出董事会决议，同意和舰有限公司认缴厦门联芯本次新增注册资本828,117万元，本次所认缴的注册资本自厦门联芯成立之日五年内缴足。

2015年1月23日，厦门联芯作出股东会决议，同意将厦门联芯的注册资本

由 15,500 万元增至 1,269,779.4 万元。厦门联芯本次新增的 1,254,299.4 万元注册资本由厦门金圆认缴 35,9461.2 万元、福建电子集团认缴 66,701.2 万元、新股东和舰有限公司认缴 828,117 万元，股东所认缴厦门联芯所有的注册资本自厦门联芯成立之日五年内缴足。

2015 年 1 月 27 日，和舰有限公司作出董事会决议，同意和舰有限公司于 2015 年第一季度完成以 1 亿美元或等值人民币投资厦门联芯。2015 年 2 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具致同验字（2015）第 350FB0016 号《验资报告》，验证截至 2015 年 1 月 30 日，厦门联芯已收到股东和舰有限公司缴纳 61,342 万元出资。2015 年 2 月 2 日，厦门联芯在厦门市工商行政管理局办理完毕前述增加注册资本的工商变更登记手续，并取得换发的注册号为 350298100001385 的《营业执照》。

2015 年 12 月 11 日，和舰有限公司作出董事会决议，同意和舰有限公司于 2016 年第一季度完成以 2 亿美元或等值人民币进行第二次投资厦门联芯。本次投资完成后，和舰有限公司对厦门联芯的出资总额达到 3 亿美元等值的人民币，持股比例约为 29.412%。2016 年 2 月 4 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具致同验字（2016）第 350FB0012 号《验资报告》，验证截至 2016 年 2 月 3 日，厦门联芯已收到股东和舰有限公司缴纳 122,684 万元出资。2016 年 4 月 29 日，厦门联芯在厦门市工商行政管理局办理完毕前述增加实收资本的工商变更登记手续，并取得换发的注册号为 91350200302849667P 的《营业执照》。

本所律师认为，和舰有限公司增资厦门联芯的行为符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

2、转让厦门联芯的部分股权

（1）2016 年 10 月 25 日，和舰有限公司作出董事会决议，同意和舰有限公司将其持有厦门联芯 21.7391% 的股权（认缴注册资本 276,039 万元、实缴出资 0 元，缴付期限 2017 年 1 月 31 日）以零元价格转让给联华微芯。

2016 年 12 月 12 日，厦门联芯作出股东会决议，同意股东和舰有限公司将

其持有厦门联芯 21.7391%的股权（认缴注册资本 276,039 万元、实缴出资 0 元，缴付期限 2017 年 1 月 31 日）转让给联华微芯，厦门联芯的其他股东厦门金圆、福建电子创业投资放弃对前述股权转让的优先受让权；厦门联芯的企业类型由有限责任公司（外商投资企业与内资合资）变更为有限责任公司（中外合资）。同日，和舰有限公司和联华微芯就前述股权转让事宜签署《股权转让协议》。

2017 年 1 月 3 日，厦门市商务局作出厦商务审[2017]02 号《厦门市商务局关于同意外资并购联芯集成电路制造（厦门）有限公司的批复》，同意和舰有限公司将持有厦门联芯 21.7391%的股权转让给联华微芯，企业类型变更为中外合资企业。

2017 年 1 月 5 日，厦门联芯取得了厦门市人民政府核发的商外资厦外资字[2017]号 0001 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2017年1月13日，厦门联芯在厦门市市场监督管理局办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续，并取得换发的统一社会信用代码为91350200302849667P的《营业执照》。

本所律师认为，和舰有限公司上述转让厦门联芯的行为符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

(2) 2017 年 12 月 12 日，和舰有限公司和厦门联芯分别作出董事会决议，同意和舰有限公司将其持有厦门联芯的 28.9855%的股权（认缴出资 368,052 万元，实际资本 0 元，缴纳期限 2018 年 1 月缴纳 245,368 万元，2019 年 1 月缴纳 122,684 万元）以零元价格转让给联华微芯。同日，和舰有限公司和联华微芯就前述股权转让签署了《股权转让协议》。

2018 年，厦门联芯取得厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201800005《外商投资企业变更备案回执》。

2018 年 1 月 9 日，厦门联芯在厦门市市场监督管理局办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续，并取得换发的统一社会信用代码为 91350200302849667P

的《营业执照》。

本所律师认为，和舰有限公司上述转让厦门联芯的行为符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

（三）股份公司出资设立山东联暲

2014年3月7日，和舰有限公司作出董事会决议，和舰有限公司投资3,000万元在山东济南高新区设立山东联暲。2014年3月25日，山东联暲在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局办理完毕其设立的工商登记手续。2014年4月15日，和舰有限公司通过中国农业银行苏州金鸡湖支行共向山东联暲汇入3000万元投资款。

本所律师认为，股份公司设立山东联暲符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

（四）厦门联芯出资设立厦门联和

2018年3月6日，厦门联芯作出董事会决议，同意厦门联芯投资厦门联和，投资总额不超过5,000万元。2018年3月23日，厦门联和在厦门市市场监督管理局办理完毕其设立的工商登记手续。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具致同验字（2018）第350FB0021号《验资报告》，经审验，截至2018年4月26日，厦门联和收到全体合伙人缴纳的51,518万元出资，其中厦门联芯缴纳5,000万元。

本所律师认为，厦门联芯投资设立厦门联和符合当时法律法规及规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序，合法、合规、真实、有效。

（五）除上述说明外，股份公司成立至今无其他合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产等行为；股份公司目前没有拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、股份公司章程的制定与修改

为查验股份公司的章程制定与修改情况，本所律师核查了与股份公司制定并修改其章程相关的会议文件、《股份公司章程》、《股份公司章程》（草案）及工商登记备案文件等资料，并将股份公司现行有效的章程与有关法律、法规和规范性文件进行了逐条比对；在此基础上，本所律师对股份公司章程的制定与修改情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）股份公司章程的制定及历次修改

1、2018年6月21日，股份公司召开股东大会，审议通过《关于制定〈和舰芯片制造（苏州）股份有限公司章程〉的议案》并报经江苏省工商行政管理局备案登记后生效。

2、2019年3月2日，股份公司召开2019年第二次临时股东大会，因股份公司首次公开发行股票并上市的需要，审议通过了《关于制定〈股份公司章程（草案）〉的议案》。《股份公司章程（草案）》于本次发行上市完成后并报送股份公司登记机构备案后生效。

（二）《股份公司章程（草案）》为依据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求制定并经股份公司股东大会审议通过。发行人已建立健全股东投票计票制度，建立发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制等制度及机制，上述制度及机制能够有效保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利，股东权利可依据《股份公司章程（草案）》得到充分保护，《股份公司章程（草案）》不存在对股东特别是中小股东行使权利的限制性规定。《股份公司章程》（草案）内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（三）股份公司现行章程制定及历次修改均已履行了必要的法定程序。

十四、股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

为查验股份公司的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况，本所律师核查了股份公司《股份公司章程》、股东大会、董事会、监事会议事规则、总经理工作制度、董事会秘书工作制度等公司治理制度的制定及修改情况、股份公司组织结构图、自股份公司成立以来历次股东大会、董事会、监事会会议通知、会议议案、表决票、会议决议、会议记录等资料，并将股份公司现行有效的股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部决策管理制度与有关法律、法规和规范性文件及《股份公司章程》规定进行了逐条比对；在此基础上，本所律师对股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）根据股份公司章程，股份公司设立了股东大会、董事会（下设审计委员会（下设内部审计处）、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会）、监事会、董事会秘书、总经理、财务负责人；股份公司目前下设股份公司目前下设生产制造处、市场销售处、资材处、厂务暨扩建处、品质暨可靠度保证处、人力资源处、会计暨财务处、风险管理暨安环处、资讯工程处、内部审计处、研究发展处等生产经营和管理部门。股份公司组织机构符合《公司法》及其他法律、法规的规定。股份公司具有健全的组织机构。

（二）股份公司已制订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《独立董事工作制度》，上述议事规则、制度符合现行法律法规和规范性文件的规定。

（三）经本所律师审查，股份公司自设立以来至今召开的股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（四）经本所律师审查，股份公司设立至今召开的股东大会、董事会历次授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、股份公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化

为查验股份公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化情况，本所律师核查了股份公司的工商登记档案、股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任免及变动的相关会议文件、股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的身份证明文件及其出具的书面声明与承诺等资料，查验了股份公司的董事、监事和高级管理人员的任职资格，并登陆中国证监会网站、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、全国法院被执行人信息查询网站进行了查询；在此基础上，本所律师对股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

(一) 股份公司现任董事、监事及高级管理人员的任职及兼职情况和核心技术人员任职情况

1、股份公司现任董事、监事及高级管理人员的任职及兼职情况

股份公司现任董事 9 名，分别为洪嘉聪、尤朝生、高明正、刘启东、郑婉伶、林俊宏、安庆衡、林凤仪、张文丽，其中，洪嘉聪任董事长，安庆衡、林凤仪、张文丽为独立董事。

股份公司现任监事 3 名，股东代表监事分别为王文杰、吕宜政，职工代表监事为朱名均，其中，王文杰任监事会主席。

股份公司现任高级管理人员 4 名，高明正任总经理，尤朝生任财务负责人，朱伟杰任董事会秘书、林伟圣任副总经理。

根据股份公司提供的材料及本所律师核查，股份公司现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形及规范性文件规定禁止任职的情形；上述人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。本所律师认为，股份公司现任董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件的规定。

2、发行人根据生产经营的需要和对企业生产经营发挥的实际作用，确定高

明正、蔡佩源、华寿崧为公司的核心技术人员，其中高明正历任发行人制程整合课经理、制程整合部经理、生产制造处副处长、处长、总经理，为发行人的技术负责人；蔡佩源为发行人的研究发展处处长，为发行人的研发负责人；华寿崧为发行人的生产制造处处长，负责制程平台的开发，为发行人研发部门主要成员。具体情况如下：

高明正：股份公司董事兼总经理，1970 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于台湾交通大学，硕士学历，电子工程专业。1995 年 6 月至 1996 年 3 月，任职于联华电子，任制程整合工程师；1996 年 3 月至 2000 年 1 月，任职于联诚集成电路股份有限公司，任制程整合工程师；2000 年 1 月至 2002 年 11 月，任职于联华电子，任制程整合课经理；2002 年 11 月至 2018 年 6 月，任职于和舰有限公司，历任制程整合课经理、制程整合部经理、生产制造处副处长、处长、总经理；2018 年 6 月至今，任和舰芯片董事兼总经理。任职发行人以来，高明正先生参与了多项制程平台开发及客制化制程平台开发项目，如 0.15 μm 和 0.11 μm e-HV 制程、0.11 μm e-Flash 制程、0.11 μm eE2PROM 制程、0.11 μm e-Flash 超低功耗制程、0.18BCD 制程等，目前其专注于产品量率提升项目，为客户提供最有效率的解决方案。

蔡佩源：研究发展处处长，1970 年出生，中国台湾籍，无境外居留权，毕业于台湾中国文化大学、台湾交通大学，硕士学历，电子工程专业。1998 年 7 月至 1999 年 9 月，任职于茂德科技股份有限公司，任研发工程处工程师；1999 年 9 月至 2003 年 12 月，任职于联华电子，任研发工程处工程师；2003 年 12 月至 2018 年 6 月，任职于和舰有限公司，历任制程整合部工程师、课经理、特殊技术发展处部经理、处长；2018 年 6 月至今，任和舰芯片研究发展处处长。蔡佩源先生参与了多个制程平台开发，现阶段其正专注于超低整合式双极性/互补金氧半组件/扩散式金氧半组件（BCD）的制程平台开发以提高和舰芯片在电源管理工艺平台的竞争力。

华寿崧先生，生产制造处处长，1971 年出生，中国台湾籍，无境外居留权，毕业于台湾清华大学，硕士学历，化学工程专业。1999 年 10 月至 2003 年 2 月，任联华电子制程整合工程师；2003 年 3 月至 2013 年 9 月，任职于和舰有限公司

制程整合课经理；2013年10月至2018年3月，任英特盛科技股份有限公司经理；2018年3月至今，任发行人生产制造处处长。华寿崧先生完成了多项制程平台开发项目，如与英飞凌合作的0.18 μm R2-UCP Flash的移植制程专项；与国外重要客户合作的高阶体声波滤波器(BAW Acoustic Filter)的移植制程专项先期评估工作与具体规划的展开；与联华电子合作的0.11 μm n-Flash制程移植；现阶段华寿崧聚焦于超低整合式双极性/互补金氧半组件/扩散式金氧半组件(BCD)的制程平台开发以提高和舰芯片在电源管理工艺平台的竞争力。

(二) 经本所律师审查，股份公司董事、监事、高级管理人员近三年来的变化情况符合法律、法规、规范性文件和股份公司章程有关规定，履行了必要的法律程序。经本所律师审查，近三年来，除核心技术人员华寿崧于2018年4月加入发行人外，其他两名核心技术人员高明正和蔡佩源一直未发生变化。

(三) 目前，安庆衡、林凤仪、张文丽为股份公司独立董事，股份公司独立董事人数占股份公司董事会成员总人数的三分之一以上，其中张文丽为会计专业人士。根据股份公司提供的有关材料以及本所律师审查，股份公司上述独立董事任职资格符合有关规定，其职权范围未违反我国法律法规及规范性文件的规定。

十六、股份公司的税务

为查验股份公司的税务情况，本所律师核查了股份公司及下属子公司的《营业执照》、税收优惠及政府补助批复或备案文件及相关财务凭证，大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、大华核字[2018]大华核字[2018]005018号《主要税种纳税情况说明的鉴证报告》，股份公司近三年纳税申报表、纳税凭证，取得了股份公司出具的声明与承诺等资料，核查相关税务主管部门出具的守法证明；并研究了相关税收优惠法律法规和规范性文件的规定；在此基础上，本所律师对股份公司的税务情况、政府补助是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

(一) 根据股份公司提供的资料及本所律师的核查，股份公司及其下属子公司目前执行的税种、税率符合我国现行法律法规及规范性文件的要求。根据股份

公司提供的资料及本所律师审查，股份公司及其下属子公司近三年来享受的税收优惠、政府补助合法、合规、真实、有效。

（二）根据股份公司提供的资料及本所律师核查，股份公司及其下属子公司近三年来不存在因违反税务方面的法律、法规而受到行政处罚的情形。

十七、股份公司的环境保护和产品质量、技术标准

为查验股份公司的环境保护和产品质量、技术等标准情况，本所律师核查了股份公司相关产品质量、技术监督、环保主管部门出具的守法证明及关于股份公司本次募投项目的环评批复文件、股份公司出具的声明与承诺；在此基础上，本所律师对股份公司的环境保护、产品质量、技术监督标准情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）股份公司的环境保护

1、股份公司及其下属子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求

根据股份公司提供的材料及本所律师核查，股份公司现持有苏州工业园区国土环保局于 2018 年 12 月 13 日核发的许可证编号为苏园环排证字[20180271]号的《排放污染物许可证》，有效期自 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 12 日。

股份公司现持有 DNV.GL 于 2016 年 9 月 24 日颁发的编号为 1578-2004-AE-RGC-RvA 的环境管理体系认证证书，股份公司的环境管理体系符合 ISO 14001:2015 标准要求，认证范围为集成电路，有效期至 2019 年 9 月 24 日。

厦门联芯现持有厦门市翔安环境保护局核发的证书编号为 350213-2018-000141 的《福建省排污许可证》，有效期自 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日。

厦门联芯现持有厦门市市政园林局核发的证书编号为厦排证字第 5032 号《排水许可证》，有效期自 2016 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日。

厦门联芯现持有 SGS 于 2017 年 10 月 25 日颁发的编号为 CN17/31382 的环境管理体系认证证书，厦门联芯的环境管理体系符合 ISO 14001:2015 标准要求，认证范围为集成电路的制造和测试，有效期至 2020 年 10 月 24 日。

和舰芯片、厦门联芯生产经营过程中产生废酸、废溶剂等危险废弃物，报告期内，上述危险废弃物均交由具有危险废物经营资质的外部单位进行处置，和舰芯片、厦门联芯分别与苏州市荣望环保科技有限公司、南京长江江宇石化有限公司、昆山德源环保发展有限公司、江苏永葆环保有限公司、江苏长山环保科技有限公司、江苏和顺环保有限公司、无锡中天固废处置有限公司、厦门东江环保科技有限公司、福建绿洲固体废弃物处置有限公司、厦门联芯与福建兴业东江环保科技有限公司、福建志坤能源科技开发有限公司、蓝保（厦门）水处理科技有限公司等企业签署了危险废弃物处置合同，根据本所律师登入国家企业信用信息公示系统对上述企业工商登记资料查阅并根据本所律师取得的上述企业拥有的危险废物经营资质证书、和舰芯片、厦门联芯与上述企业签订的危险废弃物处置合同等资料，报告期内，和舰芯片、厦门联芯生产过程中产生的危险废弃物的处置合法、合规。

根据苏州工业园区国土环保局、厦门市翔安环境保护局出具的情况说明、股份公司提供的资料及本所律师核查，股份公司及其下属子公司近三年来没有因环境违法受到环保部门的行政处罚。

2、关于股份公司本次募集资金投资项目的环境保护

股份公司本次募集资金投资的和舰芯片制造（苏州）股份有限公司集成电路芯片技术改造产能扩充项目于 2018 年 10 月 31 日取得苏州工业园区国土环保局出具档案编号为 002341800 《建设项目环保审批意见》。

（二）股份公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准

根据股份公司提供的有关材料及本所律师核查，股份公司目前如下与质量相关的认证：

1、股份公司现持有 DQS 于 2018 年 4 月 12 日颁发的注册号为 50050411IATF16 的质量管理体系认证证书，股份公司的质量管理体系符合 IATF 16949:2016 标准要求，认证范围为半导体集成电路晶圆设计及制造，有效期至 2021 年 4 月 11 日。

2、股份公司现持有 DQS 于 2018 年 4 月 12 日颁发的证书注册号为 50050411QM15 的质量管理体系认证证书，股份公司质量管理体系符合 ISO 9001:2015 标准要求；认证的范围为半导体集成电路晶圆设计及制造，有效期至 2021 年 4 月 11 日。

3、股份公司现持有 Bsi 于 2017 年 4 月 4 日颁发的注册号为 IECQ-H BSI 14.0005 注册证书，股份公司有害物质过程管理系统符合 IECQ QC 080000: 2012 要求，认证范围为集成电路的制造、封装及相关材料的处理范畴，有效期至 2020 年 4 月 3 日。

4、股份公司现持有 Bsi 于 2018 年 8 月 3 日换发的注册号为 IS581023 的注册证书，经认证，股份公司的信息安全管理符合 ISO/IEC 27001: 2013 标准要求；信息安全管理包括股份公司资讯工程处为股份公司运营管理信息系统和生产制造信息系统提供开发和运维服务，以及为 IT 基础设施提供运维服务，这与 2018 年 5 月 31 日发布的实用性声明 V6 版本一致，有效期至 2021 年 8 月 18 日。

5、厦门联芯现持有 DQS 于 2018 年 4 月 25 日颁发的证书注册号为 50600175 QM15 的质量管理体系认证证书，厦门联芯的质量管理体系符合 ISO 9001:2015 标准要求；认证的范围为集成电路芯片 IP/库之设计及相关的制造，有效期至 2021 年 4 月 24 日。

6、厦门联芯现持有 SGS 于 2017 年 12 月 8 日颁发的编号为 CN17/31583 的管理体系认证证书，厦门联芯的管理体系符合 OHSAS 18001:2007 标准要求，认证范围为集成电路的制造和测试，有效期至 2020 年 12 月 7 日。

7、厦门联芯现持有 DQS 于 2018 年 4 月 30 日核发的注册号为 IECQ-H ULTW 18.0004 注册证书，厦门联芯有害物质过程管理系统符合 IECQ QC 080000:2017 要求，认证范围为集成电路芯片 IP/库之设计及相关的制造范围内的所有电子元器件、组装件、相关物料过程，有效期至 2021 年 4 月 29 日。

8、厦门联芯现持有 DQS 于 2018 年 4 月 25 日颁发的注册号为 50600175IATF16 的质量管理体系认证证书，厦门联芯的管理体系符合 IATF 16949:2016 标准要求，认证范围为集成电路芯片 IP/库之设计及相关的制造，有效期至 2021 年 4 月 24 日。

根据苏州工业园区市场监督管理局、厦门市质量技术监督局、济南高新技术产业开发区管委会市场监管局出具的证明、股份公司提供的资料及本所律师核查，股份公司及其子公司近三年以来在生产经营活动中严格遵守国家及地方有关产品质量和技术监督方面的法律、法规，未受到质量技术监督主管部门的行政处罚。

十八、股份公司募集资金的运用

为查验股份公司募集资金的运用情况，本所律师核查了股份公司本次发行上市批准程序、业务经营情况、《和舰芯片制造（苏州）股份有限公司集成电路芯片技术改造产能扩充项目可行性研究报告》、相关政府部门的批复或备案文件等资料，在此基础上，本所律师对股份公司募集资金投资项目的情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

（一）根据股份公司提供的材料及本所律师核查，股份公司本次发行募集资金投资项目如下：

股份公司本次募集资金投资的和舰芯片制造（苏州）股份有限公司集成电路芯片技术改造产能扩充项目于 2018 年 7 月 31 日取得苏州工业园区行政审批局（经信）对前述项目完成备案，项目代码为 2018-320590-39-03-644753。

2018 年 10 月 31 日，苏州工业园区国土环保局出具档案编号为 002341800

《建设项目环保审批意见》，同意上述项目在申请地址开展建设。

2018年11月19日，苏州市发展和改革委员会出具苏发改能评[2018]第13号《关于集成电路芯片技术改造产能扩充项目节能报告的审查意见》，同意上述项目建设投资。

股份公司上述募股资金投资项目经股份公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并已取得相关主管部门备案。

(二) 上述募股资金投资项目不存在涉及与他人进行合作的情况。

(三) 股份公司本次发行募集资金投资项目用地情况

根据股份公司提供的资料，股份公司本次发行上市的募集资金投资项目和舰芯片制造（苏州）股份有限公司集成电路芯片技术改造产能扩充项目在股份公司原有厂区内进行扩建，股份公司现持有募投项目所在地的苏（2018）苏州工园区不动产权第0000182号《不动产权证书》，坐落于苏州工业园区星华街333号，面积为215,621.42平方米，用途为工业用地，权利性质为出让，终止日期为2052年12月9日。

综上所述，本所律师认为，上述募集资金投资项目符合国家产业、投资管理、土地、环境保护等法律、法规和政策的规定。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争或者对股份公司独立性产生不利影响，本次募集资金投资项目实施不存在法律障碍。

十九、股份公司业务发展目标

为查验股份公司的业务发展目标，本所律师核查了招股说明书、股份公司出具的声明与承诺等资料，分析了与股份公司主营业务有关的国家产业政策；在此基础上，本所律师对股份公司业务发展目标的情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

(一) 根据股份公司提供的资料及本所律师核查，股份公司业务发展目标与股份公司主营业务一致。

(二) 经本所律师审查，股份公司的业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

为查验股份公司的诉讼、仲裁或行政处罚情况，本所律师核查了股份公司出具的声明与承诺，股份公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员出具的声明与承诺等资料，各相关政府主管部门出具的证明文件，登入全国法院被执行人信息查询网站；取得了（台湾）普华商务法律事务所出具的《查核法律意见书》；在此基础上，本所律师对股份公司诉讼、仲裁或行政处罚的情况是否符合《公司法》、《证券法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》以及其他法律、法规、规范性文件的规定予以验证。

(一) 关于股份公司及其下属子公司、股份公司诉讼、仲裁或行政处罚事项

根据大华会计师事务所出具的大华审字[2019]001939号《审计报告》、股份公司提供的行政处罚决定书、政府部门开具的合法合规证明及本所律师对相关政府部门的走访，股份公司及其下属子公司在报告期内受到过的行政处罚如下：

1、2016年8月19日，中华人民共和国苏州工业园区海关对和舰有限公司作出“苏园关缉违字[2016]0101号”《中华人民共和国工业园区海关行政处罚决定书》，和舰有限公司于2015年3月23日、2015年7月22日，将申报出口维修进口的晶片缺点检测机的税则号由“9031410000”错写为“9030820000”，违反海关监管的规定，被苏州工业园区海关处以1,000元罚款。和舰有限公司于2016年8月19日足额缴纳了上述付款。

2018年7月13日，中华人民共和国苏州工业园区海关出具编号为“苏园关2018年25号”《证明》，经该海关认定，发行人前述因申报不实违规被海关行政处罚不属于重大违法违规情形。

2、2017年3月8日，苏州市公安消防支队工业园区大队对和舰有限公司作出“苏园公（消）行罚决字[2017]0040号”《行政处罚决定书》，因和舰有限公司一期厂房钢结构防火涂料施工厚度未达到要求，违反《中华人民共和国消防法》的相关规定，被苏州市公安消防支队工业园区大队处以5,000元的罚款。和舰有限公司于2017年3月10日足额缴纳了前述罚款，并执行了整改加强措施。

2018年8月30日，苏州市公安消防支队工业园区大队出具《证明》，发行人自2015年1月1日至今，一直遵守消防管理方面的法律法规，不存在有重大违反消防管理方面的法律、法规和规范性文件的情形，也不存在有因违反消防管理方面的法律、法规和规范性文件而受到严重处罚的情形。

根据股份公司提供的有关材料以及本所律师核查，股份公司及其下属子公司厦门联芯、山东联曠目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。报告期内，发行人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（二）根据股份公司提供的有关材料及本所律师核查，股份公司董事、监事、高级管理人员目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

（三）根据股份公司提供的有关材料及本所律师核查，直接、间接持有股份公司股份5%以上的股东橡木联合、菁英国际、晶信科技目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

根据发行人提供的资料及联华电子的相关公告，间接持有股份公司股份5%以上股东联华电子目前存在尚未了结的重大诉讼，具体情况如下：

1、联华电子与美国 Micron Technology, Inc.（以下简称“美光公司”）之间的诉讼

(1) 2017年8月，台湾台中地方法院检察署以联华电子员工涉嫌侵害美光公司营业秘密为由对联华电子提起刑事诉讼，台湾台中地方法院检察署指控联华电子涉嫌违犯台湾营业秘密法的规定，并依据台湾营业秘密法的规定，请求对联华电子科以罚金刑。本案目前尚在审理中。

(2) 2017年12月，美光公司向美国加州北区联邦地方法院对联华电子提起民事诉讼（Micron Technology, Inc., v. United Microelectronics Corporation, et al., CV 06932），请求赔偿所遭受的实际损失、返还联华电子因侵害其商业秘密而取得的利益、惩罚性赔偿等，并请求法院禁止联华电子获取、披露、使用、复制其营业秘密。本案目前尚在审理中。

(3) 2018年9月，美国加州北区联邦检察官办公室向美国加州北区法院（圣何塞分部）提起刑事诉讼（United States v. United Microelectronics Corporation, et al., CR 18 465 (LHK/SVK)），美国政府指控联华电子与若干员工涉嫌违犯美国法典第18篇的规定共谋窃取美光公司的营业秘密以及采取经济间谍行为，并指控联华电子利用被窃取的营业秘密，请求对联华电子科以最高不超过1,000万美元、或被窃取的营业秘密对犯罪人而言之价值（包括犯罪人所节省的研发、设计及其他重制该营业秘密的费用）3倍（孰高）的罚金、承担被害人赔偿金等。本案目前尚在审理中。

(4) 2018年11月，美国加州北区联邦检察官办公室向美国加州北区法院（圣何塞分部）提起民事诉讼（United States v. United Microelectronics Corporation, et al., CV 06643），美国政府指控联华电子与若干员工共谋窃取美光公司之营业秘密以及采取经济间谍行为，请求禁止联华电子使用美光公司的营业秘密。其中，关于出口、转出口、使他人出口至美国之联华电子制造的 DRAM 之产品；以直接或间接方式贩卖或提供至美国联华电子制造的 DRAM 之产品；或使他人进口至美国任何包括由福建晋华或联华电子制造的 DRAM 之产品，以及任何为规避前述禁制令之其他任何交易，或再将美光公司营业秘密转让他人，均属

前述禁制令之申请范围内。本案目前尚在审理中。

就联华电子与美光公司上述于中国台湾地区及美国所涉之诉讼以下统称“美光诉讼案”。根据发行人提供的资料及本所律师核查，美光诉讼案的情况如下：

2016年1月，联华电子与福建晋华洽谈，双方协议进行F32纳米随机固态硬盘芯片（DRAM）及F32S纳米DRAM相关制程技术开发，由福建晋华提供3亿美元资金采购研发设备并依开发进度陆续支付联华电子4亿美元，开发成果由双方共同拥有，整体技术完成后将转移至福建晋华进行F32纳米DRAM及F32S纳米DRAM之量产。

2016年3月11日，联华电子向经济部投资审议委员会申请签署技术合作案，2016年4月12日，经济部投资审议委员会以经审二字第1050005030号函核准。

经本所律师登入“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”对福建晋华的查询，福建晋华成立于2016年02月26日，其现时持有福建省晋江市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91350582MA3465Y92B《营业执照》，法定代表人为卢文胜，企业类型为其他有限责任公司，注册资本为1,144,482.5万元，住所为福建省泉州市晋江市集成电路科学园联华大道88号，经营范围为“集成电路制造；货物或技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，其股东为福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、福建省国开晋华产业股权投资合伙企业（有限合伙）、福建省晋江产业发展投资集团有限公司、泉州市金融控股集团有限公司、泉州农金集成电路投资合伙企业（有限合伙）。

依据台湾台中地方法院检察署检察官起诉书，台湾美光公司、美光公司为自身利益并阻止联华电子合作方福建晋华研发、生产、销售随机固态硬盘芯片（DRAM），台湾美光公司、美光公司提出告诉并经台湾台中地方法院检察署检察官指挥法务部调查局新北市调查处调查后，由台湾台中地方法院检察署以联华电子员工、联华电子违反营业秘密法为由向台湾台中地方法院提起公诉，随后，美光公司以美国国内法向美国加州北区联邦地方法院对联华电子提起民事诉讼及美国加州北区联邦检察官办公室以联华电子、福建晋华等涉嫌违反美国法律

为由提起刑事诉讼和民事诉讼。

2018年6月，联华电子（原告）以美光半导体销售（上海）有限公司（第一被告）、厦门市思明区信通源电脑经营部（第二被告）侵犯其专利权（专利号为：ZL200310103485.9）为由向福州市中级人民法院提起诉讼。联华电子（原告）以美光半导体（西安）有限责任公司（第一被告）、美光半导体销售（上海）有限公司（第二被告）、厦门市思明区信通源电脑经营部（第三被告）侵犯其专利权（专利号为：ZL03100966.2）为由向福州市中级人民法院提起诉讼。

2018年7月3日，福州市中级人民法院出具（2018）闽01民初136号之一、（2018）闽01民初137号之二《民事裁定书》，裁定的主要内容为：美光半导体销售（上海）有限公司立即停止销售、进口Crucial 英睿达MX300 2.5英寸SSD525固态硬盘及NW853芯片等等产品；美光半导体（西安）有限责任公司立即停止制造、销售、进口铂胜运动Ballistix 铂胜台式内存DDR424008G两条装及BX芯片等等产品。

根据（台湾）普华商务法律事务所出具的《专项法律意见书》及联华电子披露的公开信息及本所律师会同保荐机构对相关人员的访谈，联华电子就美光诉讼案说明如下：

（1）联华电子具有近15年研发DRAM产品制程的经验。联华电子曾拥有超过150人的DRAM研发团队。联华电子掌握并保存了丰富的DRAM知识和经验且具有坚实而稳定的团队，除传统的DRAM技术外，2009年联华电子成功开发了属于自己的嵌入式DRAM制程技术，此与制造标准型DRAM的过程要复杂得多。

（2）联华电子与福建晋华联合开发DRAM制程技术，属于符合合理商业逻辑的单纯商业交易项目，且中国台湾政府主管部门已于2016年4月核准整个项目。

（3）联华电子为了与福建晋华合作开发DRAM制程技术并履行合同义务，联华电子已投入数亿新台币。本合作项目的研发团队规模接近300人，联华电子招募的上述研发团队成员仅有不到10%的人曾在美光公司工作过。

(4) 联华电子 DRAM 技术基础里的组件设计，是完全不同于美光公司的设计。联华电子开发的记忆胞架构是 3x2 布局的储存单元，与美光公司的 2x3 布局的储存单元完全不同。

(5) 目前，联华电子与福建晋华合作开发 DRAM 制程尚处于研发阶段，尚未实际投入生产或销售任何 DRAM 之产品。

(6) 虽联华电子具有 DRAM 制程之技术实力、经验，但基于联华电子战略定位及市场考虑联华电子集团旗下之所有公司其所制造量产或销售之产品并不包含 DRAM 或任何包含 DRAM 之产品。

根据普华商务法律事务所出具的《专项法律意见书》，根据美国、台湾法律规定及美国法院过往审理案例，美光诉讼案即使产生不利后果对联华电子而言，其承担的法律责任为被处罚金、没收财产、赔偿损失、禁止相关产品出口、转出口至美国等，根据联华电子 2017 年度报告及 2018 年财报及其出具的声明，联华电子完全具有背负美光诉讼案不利后果之实力，不会对联华电子之持续经营构成重大影响。同时，根据普华商务法律事务所出具的《专项法律意见书》，美光诉讼案不涉及对联华电子现有董事、高级管理人员之追诉的情形。

2、International Business Machines Corporation（以下简称“IBM”）诉联华电子案

根据（台湾）普华商务法律事务所出具的《法律意见书》及联华电子披露的公开信息，IBM 于 2016 年 7 月 1 日于美国联邦纽约南区地方法院对联华电子提起技术授权权利金之给付诉讼。美国联邦纽约南区地方法院于 2017 年 9 月 15 日判决联华电子应给付授权金 1,000 万美元并加计年利率 12% 之利息，联华电子对上述判决结果不服，向美国联邦第二巡回法院提出上诉。美国联邦第二巡回法院于美国东部时间 2017 年 12 月 8 日予以调解，但鉴于双方未能达成调解，就上述诉讼，美国联邦第二巡回法院尚在审理中。

本所律师认为，美光诉讼案及 IBM 诉联华电子案不会对联华电子持续经营产生重大不利影响，不会对发行人股权结构、生产经营、未来发展产生重大不利影

响，对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。

综上所述，本所律师认为，报告期内，发行人控股股东橡木联合、菁英国际、晶信科技、联华电子不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《科创板首发管理办法》的相关规定。

（四）根据相关劳动和社会保障主管部门出具的证明及本所律师核查，股份公司及其下属子公司近三年来未有违反有关劳动和社会保障法律、法规的情形，亦不存在违反劳动和社会保障法律、法规而受处罚的情形。

二十一、股份公司招股说明书的法律风险评价

本所律师参与了股份公司招股说明书的编制及讨论，已审阅股份公司招股说明书，并对股份公司引用《法律意见书》和《律师工作报告》的相关内容进行了认真审阅。股份公司招股说明书及其摘要不存在因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而引致的法律风险。

二十二、结论意见

本所律师通过对股份公司提供的材料及有关事实审查后认为，股份公司本次发行申请符合《证券法》、《公司法》、《科创板首发管理办法》、《科创板上市规则》及其他有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文件规定的公开发行股票并在科创板上市的有关条件，其公开发行股票并在科创板上市不存在任何法律障碍。股份公司不存在影响本次发行的违法、违规行为。股份公司本次发行现阶段已履行了必要的法律程序，股份公司本次发行上市尚需获得上海证券交易所审核及中国证监会同意注册。股份公司招股说明书及其摘要引用的法律意见书和律师工作报告的内容准确、适当。

本法律意见书正本两份，副本四份。

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》签字、盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

罗会远：

经办律师（签字）：

李冬梅：

井泉：

2019年 3月21日